

股票简称：鹏鼎控股

股票代码：002938

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

(Avary Holding (Shenzhen) CO., LTD.)

(广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号
鹏鼎时代大厦)



2026 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书



保荐机构（主承销商）



(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)

2026 年 10 月

声 明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本次证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次发行概况

1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会临时会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册批文后，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果以及公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。

4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前公司总股本的 10%，即

231,753,665 股（含本数），最终向特定对象发行股票数量计算至个位数（计算结果向下取整），并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票数量的上限将作相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

5、本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

6、本次发行拟募集资金总额不超过 960,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目	1,273,001.16	960,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

7、本次向特定对象发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、关于公司利润分配政策、现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、股东回报规划等情况，详见本募集说明书“第二节 发行人基本情况/七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况”。

9、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公

司新老股东按照本次发行完成后的股份比例共同享有。

10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，相关情况详见本募集说明书“第八节 与本次发行相关的声明/七、董事会声明/（二）本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施”，请投资者予以关注。

公司所制定的填补回报措施不等于对于公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关发行方案之日起 12 个月。

二、重大风险提示

本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第七节 与本次发行相关的风险因素”，注意投资风险，并特别注意以下风险：

1、募集资金投资项目不及预期的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断作出的，在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术革新、产业政策调整、市场变化、行业整体扩张导致竞争加剧等诸多不确定因素，该等因素对募投项目实施有较大影响。如募集资金投资项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化、公司不能有效开拓新市场，公司产能扩大后将存在一定的产品滞销风险，募集资金投资项目新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现一定下降。

2、固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，在项目建设达到预定可使用状态后，公司将新增较大金额的固定资产折旧。**本次募集资金投资项目新增折旧摊销预计在项目开始建设起第四年达到峰值 11.30 亿元，占公司当年营业收入的比例为 2.41%。**如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

3、新增产能不能及时消化的风险

本次募投项目实施后，公司将新增约 65.56 万平方米高阶 HDI 年产能。由于相关项目完全投产尚需一定时间，在后续项目实施及经营过程中，如果行业政策、下游客户需求、市场环境发生重大不利变化，或公司相关产品市场开拓不及预期，可能将导致本次募投项目新增产能不能及时消化，可能会对项目预期投资收益及公司盈利能力产生一定不利影响。

4、行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯、消费电子及计算机产品，具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求，或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、无法对新的市场需求和技术趋势作出及时反应，公司业绩将受到不利影响，未来将可能面临丧失竞争优势的风险。

5、原材料供应和价格波动风险

公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将对公司产品的毛利率水平产生一定影响。此外，公司生产中需要大量电力，电力供应及电力价格亦受能源供应及能源价格波动影响。当前全球地缘政治冲突与气候变化持续加剧，全球能源及大宗商品市场价格出现波动。公司可能面临原材料和能源成本上涨的经营风险。

与此同时，下游电子行业迅猛发展，带动了行业需求的快速增长，并传导至 PCB 产品上游。在此背景下，主要原材料可能存在短期内产能紧张的情形，公

司可能面临原材料供应的经营风险。

6、经营业绩波动风险

2026 年 1-6 月，公司产品结构持续优化，高附加值、高毛利相关产品营收占比稳步提升，带动整体毛利率水平改善，但与此同时，受研发费用、财务费用增加等因素影响，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降 22.31%。

目前，公司的算力领域业务处于爬坡放量阶段，若未来公司相关领域拓展不及预期、所处行业的产业政策、供需情况、原材料和能源价格发生不利变化，或出现其他自身经营的不利因素，则可能对公司的经营业绩、**本次募投项目的效益实现**产生不利影响。

目 录

声 明.....	1
重大事项提示	2
一、本次发行概况.....	2
二、重大风险提示.....	4
第一节 释 义	9
第二节 发行人基本情况	12
一、发行人基本信息.....	12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况.....	12
三、发行人所处行业的基本情况.....	15
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容.....	37
五、现有业务发展安排及未来发展战略.....	42
六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况.....	45
七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况.....	55
八、同业竞争情况.....	61
九、报告期内违法违规情况.....	64
十、发行人最近一期业绩波动情况.....	65
十一、报告期内深交所对公司年度报告的问询情况.....	65
十二、与发行人有关的舆情情况.....	65
第三节 本次证券发行概要	66
一、本次发行的背景和目的.....	66
二、发行对象及与发行人的关系.....	69
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期.....	69
四、募集资金金额及投向.....	72
五、本次发行是否构成关联交易.....	72
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化.....	72
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	73
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	74

一、本次募集资金投资项目的必要性和可行性.....	74
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....	80
三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性.....	83
四、本次募集资金直接或变相用于类金融业务的情况.....	83
五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”	83
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	85
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划.....	85
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况.....	85
三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况.....	85
四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况.....	85
五、实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响.....	86
第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况	87
第七节 与本次发行相关的风险因素	88
一、宏观经济风险.....	88
二、经营风险.....	88
三、财务风险.....	90
四、募集资金投资项目风险.....	91
五、向特定对象发行股票项目相关风险.....	92
第八节 与本次发行相关的声明	94
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.....	94
二、发行人审计委员会声明.....	95
三、发行人控股股东声明.....	96
四、保荐人声明.....	99
五、发行人律师声明.....	101
六、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明.....	102
七、发行人董事会声明.....	103

第一节 释 义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一、基本定义		
鹏鼎控股/公司/本公司/发行人/上市公司	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
美港实业/控股股东	指	美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited），注册于中国香港之发行人控股股东
集辉国际	指	集辉国际有限公司（Pacific Fair International Limited），注册于中国香港之发行人控股股东的一致行动人
臻鼎控股/间接控股股东	指	臻鼎科技控股股份有限公司（Zhen Ding Technology Holding Limited），注册于英属开曼群岛之中国台湾上市公司（4958.TW），发行人间接控股股东
悦沣公司	指	悦沣有限公司（Jovial Limited），注册于中国香港之发行人员工持股平台
富柏工业	指	富柏工业（深圳）有限公司，发行人境内全资子公司
宏恒胜	指	宏恒胜电子科技（淮安）有限公司，发行人境内全资子公司
宏启胜	指	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司，发行人境内全资子公司
庆鼎精密	指	庆鼎精密电子（淮安）有限公司，发行人境内全资子公司
鹏鼎投资	指	鹏鼎控股投资（深圳）有限公司，发行人境内全资子公司
鹏鼎国际	指	鹏鼎国际有限公司，发行人中国香港全资子公司
鹏鼎科技	指	鹏鼎科技股份有限公司，发行人中国台湾全资子公司
无锡华阳	指	无锡华阳科技有限公司，发行人境内控股子公司
无锡永阳	指	无锡永阳电子科技有限公司，无锡华阳参股公司
广东展扬	指	广东展扬智能装备有限公司，发行人境内参股公司
Monterey	指	Monterey Park Finance Limited，注册于英属维尔京群岛之发行人间接股东、臻鼎控股全资子公司
Coppertone	指	Coppertone Enterprises Limited，注册于英属维尔京群岛之发行人间接股东、臻鼎控股全资子公司
FAT	指	FAT Holdings Limited，注册于开曼群岛之臻鼎控股全资子公司
臻鼎科技	指	臻鼎科技股份有限公司，注册于中国台湾之臻鼎控股全资子公司
新加坡臻鼎	指	Zhen Ding Technology Singapore Private Limited，注册于新加坡之臻鼎控股全资子公司
先丰通讯	指	先丰通讯股份有限公司，注册于中国台湾之臻鼎控股全资子公司
嘉维实业	指	淮安嘉维实业发展有限公司，Monterey 之全资子公司
礼鼎半导体	指	礼鼎半导体科技（深圳）股份有限公司，Monterey 控股子公司
礼鼎国际	指	Leading Interconnect International Limited，注册于中国香港之礼鼎半导体全资子公司

礼鼎秦皇岛	指	礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司，礼鼎半导体全资子公司
曜鼎深圳	指	曜鼎环能科技（深圳）有限公司，臻鼎控股全资子公司
曜鼎秦皇岛	指	曜鼎环能科技（秦皇岛）有限公司，臻鼎控股全资子公司
曜鼎淮安	指	曜鼎环能科技（淮安）有限公司，臻鼎控股全资子公司
鸿海集团	指	鸿海精密工业股份有限公司，注册于中国台湾之上市公司（2317.TW），或根据上下文，指鸿海精密工业股份有限公司及其子公司
深南电路	指	深南电路股份有限公司，中国大陆印制电路板上市公司（002916.SZ）
景旺电子	指	深圳市景旺电子股份有限公司，中国大陆印制电路板上市公司（603228.SH）
沪电股份	指	沪士电子股份有限公司，中国大陆印制电路板上市公司（002463.SZ）
胜宏科技	指	胜宏科技（惠州）股份有限公司，中国大陆印制电路板上市公司（300476.SZ）
健鼎科技	指	健鼎科技股份有限公司，注册于中国台湾之上市公司（3044.TW）
华通电脑	指	华通电脑股份有限公司，注册于中国台湾之上市公司（2313.TW）
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司，中国大陆印制电路板上市公司（002384.SZ）
股东会	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司股东会
董事会	指	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会
本次发行	指	鹏鼎控股 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
发行方案	指	鹏鼎控股 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
定价基准日	指	发行期首日
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
中共中央	指	中国共产党中央委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》及历次章程修正案
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年、2024 年、2025 年、2026 年 1-6 月
最近三年	指	2023 年、2024 年、2025 年

报告期各期末	指	2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2026 年 6 月 30 日
二、专业术语		
Prismark	指	Prismark Partners LLC，美国公司，印制电路板行业权威咨询机构
印制电路板/PCB	指	Printed Circuit Board，又称印制线路板、印刷电路板、印刷线路板，组装电子零件用的基板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。PCB 是电子元器件电气相互连接的载体，是电子产品的基础元器件
刚性板/R-PCB	指	Rigid Printed Circuit Board，刚性印制电路板
柔性板/FPC	指	Flexible Printed Circuit，柔性印制电路板
刚挠结合板/Rigid Flex	指	是一种兼具刚性 PCB 的耐久力和柔性 PCB 的适应力的印制电路板
SMA	指	表面贴装或表面安装技术
单面板	指	在绝缘基材上仅一面具有导电图形的印制电路板
双面板	指	绝缘基材的两面都有导电图形的印制电路板
多层板	指	具有 4 层及以上导电图形的印制电路板
HDI	指	High Density Interconnector，高密度连接板，针对 PCB 线路互连密度高而言。通常指线宽/线距 0.1mm 以下，小导通孔孔径 0.15mm 以下，含有盲孔和埋孔的多层板
SLP/类载板	指	substrate-like PCB，在 HDI 技术的基础上，采用 mSAP 等工艺制程进一步细化线路的新一代精细印制电路板，相较于传统 HDI 线宽线距更小
mSAP	指	Modified Semi-Additive Process，半加成法
HLC	指	High Layer Count，高多层板，通常指层数在 16 层以上、采用多次压合工艺叠合而成的高端刚性印制电路板
Any-layer HDI	指	任意层高密度连接板，以雷射钻孔打通每一层之间的连通，相对于一般 HDI 加工难度更高
CoWoP	指	Chip-on-Wafer-on-PCB，是一种先进的系统级芯片封装技术，通过将芯片和硅中介层直接安装到 PCB 上，实现高密度互连和高带宽性能
AI	指	Artificial Intelligence，人工智能，让机器/芯片/软件拥有类似人的感知、思考、推理、学习、决策、创作能力
AI Agent	指	人工智能智能体，以大语言模型为认知核心，具备自主感知、理解推理、任务规划、工具调用、记忆存储与动态学习能力，能在最少人工干预下，目标导向地完成多步骤、复杂任务的自治智能系统
GPU	指	Graphics Processing Unit，图形处理器，进行图形和图像相关运算工作的微处理器
CPU	指	Central Processing Unit，中央处理器，为计算机系统中执行运算指令和控制指令的核心部件，是控制计算机完成信息处理、程序运行等工作的重要单元
XPU	指	XPU 是一种涵盖 CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、NPU（神经网络处理单元）、FPGA、ASIC、DPU 等多种异构处理器组合而成的异构计算架构
ASIC	指	Application Specific Integrated Circuit，为特定应用场景定制设计的集成电路芯片，相比通用芯片具有更高性能和能效比

注：本募集说明书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

英文名称：Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited

注册地址：广东省深圳市宝安区新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：鹏鼎控股

股票代码：002938.SZ

成立日期：1999-04-29

上市日期：2018-09-18

法定代表人：沈庆芳

经营范围：生产经营新型电子元器件、自动化设备及其零配件、精密模具及其零件、各类印刷电路板、电子信息产品板卡。从事电子信息产品及其板卡的批发、进出口及相关配套业务；自有房屋租赁；仓储服务；从事 A002-0061 宗地（即“鹏鼎时代大厦”）的房地产开发、经营、租赁、销售；物业管理；经营性机动车停车场。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人股权结构

1、股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的股本结构如下：

股份类型	持股数（股）	持股比例
有限售条件股份	8,153,993	0.35%

股份类型	持股数（股）	持股比例
无限售条件股份	2,309,382,665	99.65%
合计	2,317,536,658	100.00%

2、发行人前十大股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十大股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份数量（股）	持股比例
1	美港实业有限公司	境外法人	1,495,810,998	64.54%
2	集辉国际有限公司	境外法人	130,834,075	5.65%
3	香港中央结算有限公司	境外法人	41,756,018	1.80%
4	中际旭创（上海）投资有限公司	境内非国有法人	24,000,000	1.04%
5	全国社保基金一零三组合	其他	22,700,000	0.98%
6	中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	其他	12,869,884	0.56%
7	悦沅有限公司	境外法人	10,318,217	0.45%
8	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	9,055,604	0.39%
9	平安银行股份有限公司－永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	6,230,616	0.27%
10	全国社保基金四一六组合	其他	5,965,207	0.26%
合计			1,759,540,619	75.92%

3、前十大股东之间关联关系

截至 2026 年 6 月 30 日，前 10 名股东中：（1）美港实业及集辉国际均为臻鼎控股（4958.TW）间接控制的全资子公司；（2）美港实业持有悦沅公司 11.82% 的股权；（3）经查询公开资料，全国社保基金一零三组合、全国社保基金四一六组合均为全国社保基金投资组合。（4）经查询公开资料，中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪及中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪均为中国人寿旗下投资产品。

4、主要股东所持股份质押、冻结、权属纠纷情况

截至 2026 年 6 月 30 日，持有发行人 5% 以上股份的股东所持发行人股份不存在质押、冻结或其他限制权利的情况。

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东美港实业、间接控股股东臻鼎控

股直接或间接持有发行人的股份不存在重大权属纠纷。

（二）控股股东及实际控制人情况

1、控股股东及实际控制人基本情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,317,536,658 股，其中美港实业直接持有公司 64.54%的股份，为公司的控股股东，其一致行动人集辉国际直接持有公司 5.65%股份。截至 2026 年 6 月 30 日，臻鼎控股间接持有美港实业和集辉国际 100%的股份，合计间接控制发行人 70.19%的股权，为发行人的间接控股股东。

公司无实际控制人，间接控股股东为中国台湾上市公司臻鼎控股。鸿海集团全资子公司 Foxconn（Far East）为臻鼎控股第一大股东，其在臻鼎控股 7 名董事会成员中仅占一席而未构成控制，且鸿海集团从未对臻鼎控股进行并表，仅对其进行权益法核算。因此，臻鼎控股无实际控制人，公司亦无实际控制人。此外，鸿海集团亦无实际控制人。

控股股东美港实业基本情况如下：

公司名称	美港实业有限公司
英文名称	Mayco Industrial Limited
公司注册编号	1185264
董事	沈庆芳
已发行股本	9,321,841,932股
注册地	Suite 1222, 12/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
主营业务	投资控股
成立日期	2007.11.14
股东构成	Coppertone持股100%

间接控股股东臻鼎控股基本情况如下：

公司名称	臻鼎科技控股股份有限公司
股票代码	4958.TW
公司注册编号	168714
注册地	英属开曼群岛
地址	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands

董事长	沈庆芳
已发行股本	1,108,887,604 股
成立日期	2006.06.05
主营业务	投资控股

控股股东一致行动人集辉国际基本情况如下：

公司名称	集辉国际有限公司
英文名称	Pacific Fair International Limited
公司注册编号	1188266
董事	沈庆芳
已发行股本	2,133,300,000股
注册地	Suite 1222, 12/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
主营业务	投资控股
成立日期	2007.11.23
股东构成	Monterey持股100%

2、控股股东报告期内的变化情况

报告期内，公司不存在控股股东变化的情况。

三、发行人所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业

发行人所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人主营业务归属于“电子元件及电子专用材料制造”中的“电子电路制造”，行业代码为 C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，发行人主营业务归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人业务属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

（二）行业监管体制和主要法律法规及政策

1、行业主管部门及管理体制

工信部是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括提出新型工业化发展

战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业等。

工信部下属的电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产，组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息技术推广应用。

印制电路板行业的自律性组织是中国电子电路行业协会（CPCA）。CPCA是隶属工信部并经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会，是世界电子电路理事会（WECC）的成员之一，由印制电路板（PCB）、覆铜箔板（CCL）等原辅材料、专用设备以及部分电子装连 SMT 和电子制造服务 EMS 的企业以及相关的科研院校组成。其职能包括：发动企业参与制订 CPCA 标准和 WECC 标准，并与 IPC 和 JPCA 制订联合标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍；主办每年 CPCA 展览会；举办每年国际 PCB 信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座等。

2、行业主要政策及法律法规

PCB 是电子信息产业的基础产品，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用。近年来，我国政府及相关部门推出了一系列法律法规、行业政策，以推进 PCB 行业的战略调整与产业升级，为国内 PCB 企业提供了良好发展契机。相关产业政策如下：

时间	部门	政策名称	有关内容
2026 年 3 月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料；围绕支撑产业升级和数智化发展，推进新型基础设施布局建设和集约高效利用；壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
2025 年 12 月	国家发改 委、商务 部	《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》	明确将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板”列入鼓励外商投资产业目录。
2025 年	工信部	《印制电路板行	鼓励印制电路板产业聚集发展，建设配套设备完备的产

时间	部门	政策名称	有关内容
11 月		业规范条件 （2025 年本）》 （征求意见稿）	业园区。鼓励企业做优做强，加强企业技术和管理创新，提高产品质量和生产效率，降低生产成本。推动建设一批具有国际影响力、技术领先、“专精特新”的企业。
2025 年 8 月	工信部、 市场监督 管理总局	《电子信息制造业 2025-2026 年 稳增长行动方案》	统筹好培育新动能和更新旧动能、做优增量和盘活存量，深化产业内生动力，以产业高质量发展的确定性沉稳应对外部环境急剧变化的不确定性，提振产业发展信心。推进人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设，提升智算云服务水平，赋能科学研究、自动驾驶、生物医药等高算力场景。支持汽车电子、海洋电子、航空电子、医疗电子等产业发展，助推产业数字化转型、智能化升级。
2025 年 4 月	工信部、 国家发改 委、数据 局	《电子信息制造业数字化转型实 施方案》	加快实体经济与数字经济深度融合，坚持创新引领、统筹谋划、因业制宜、安全有序，深化数字技术应用，提高电子信息制造业数字化、网络化、智能化水平，推动生产方式和组织形态变革，打造发展新模式、新业态，培育新增长点，加快电子信息制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展，为推进新型工业化、建设现代化产业体系提供有力支撑。
2023 年 12 月	国家发改 委	《产业结构调整 指导目录（2024 年本）》	将高频高速印制电路板、特种印制电路板等继续列为鼓励类产业。

（三）行业发展现状和发展趋势

1、行业发展概况

（1）PCB 的定义

PCB 英文全称为 Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上，按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路，而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形，称为印制线路。PCB 的雏形来源于 20 世纪初利用“线路”（Circuit）概念的电话交换机系统，它是用金属箔切割成线路导体，将之黏着于两张石蜡纸中间制成。真正意义上的 PCB 诞生于 20 世纪 30 年代，它采用电子印刷术制作，以绝缘板为基材，切成一定尺寸，其上至少附有一个导电图形，并布有孔（如组件孔、紧固孔、金属化孔等），用来代替以往装置电子元器件的底盘，并实现电子元器件之间的相互连接，起中继传输的作用，是电子元器件的支撑体，有“电子产品之母”之称，PCB 产业的发展水平可在一定程度上反映一个地区电子产业的整体发展速度与技术水准。在 AI 算力系统的发展过程中，PCB 更是逐渐成为“神经中枢”，为 AI 服务器、高速光模块等算力领

域硬件提供核心互联载体与基础支撑。

(2) PCB 的分类

PCB 产品品类众多，可按产品结构、导电图形层数、板材类型和产品用途等使用多种分类方法。

①按导电图形层数分类：

产品种类	简介
单面板	最基本的印制电路板，零件集中在其中一面，导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面，所以称为单面板，主要应用于较为早期的电路。
双面板	在绝缘基板两面均有导电图形，由于两面都有导电图形，一般采用金属化孔使两面的导电图形连接起来，此类 PCB 可以通过金属孔使布线绕到另一面而相互交错，因此可以用到较复杂的电路上。
多层板	有四层或四层以上导电图形的印制电路板，内层是由导电图形与绝缘粘结片叠合压制而成，外层为铜箔，经压制成为一个整体。为了将夹在绝缘基板中间的印刷导线引出，多层板上安装元件的孔（即导孔）需经金属化孔处理，使之与夹在绝缘基板中的印刷导线连接。多层板导电图形的制作以感光法为主。层数通常为偶数，并且包含最外侧的两层。

②按产品结构分类：

产品种类	产品特性	应用领域
刚性板（硬板）	由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。	计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子和汽车电子等。
柔性板（软板）	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩,从而达到元器件装配和导线连接一体化。	智能手机、笔记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等。
刚挠结合板	指在一块印制电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区，将薄层状的挠性印制电路板底层和刚性印制电路板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求。	先进医疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等。
HDI 板	High Density Interconnect 的缩写，即高密度互连技术，是印制电路板技术的一种。 HDI 板是刚性板的一种，一般采用积层法制造，采用激光打孔技术对积层进行打孔导通，使整块印刷电路板形成了以埋、盲孔为主要导通方式的层间连接。相较于传统多层印制板，HDI 板可提高板件布线密度，有利于先进封装技术的使用；可使信号输出品质提升；还可以使电子产品在外观上变得更为小巧方便。	高密度互连需求突出的消费电子及 AI 算力基础设施等。
SLP 板	SLP 作为 HDI 的一类产品，应用 mSAP 工艺，线宽线距更细，制程难度进一步提升，可视为常规 HDI 的升级产品。	手机主板、笔记本主板、高速光模块等。

产品种类	产品特性	应用领域
HLC 板	通常指层数在 16 层以上、采用多次压合工艺叠合而成的高端刚性印制电路板。具有极高的布线密度和信号通道数量，通过多层信号层、电源层和地层的精密叠合，实现海量信号的高速稳定传输。	AI 服务器背板、超级计算机主板、高速 AI 交换机、大型电信设备主干传输板等。

③按板材类型分类：

产品种类	简介	应用领域
普通板	主要是指采用 FR4 覆铜板（通常指 $Dk > 4.0@11\text{GHz}$ ， $Df > 0.015@1\text{GHz}$ 的覆铜板材料）制造的印制电路板。该类印制电路板主要解决简单的电气通断，对信号完整性要求相对较低。	通信设备、网络设备、计算机/服务器、消费电子、工控医疗及其他等。
高频板	高频 PCB 是电磁频率较高（1GHz 以上）的特种电路板；主要是采用高频板材（该类板材在使用环境中以及电磁信号频率发生变化时具有稳定的 Df （介质损耗）和 Dk （介电常数），对温湿度变化和长期老化条件下的电性能波动的指标要求较高。高频材料相比高速材料，对 Df 要求通常更高，绝大多数材料 Df （介质损耗） < 0.004 （10GHz）制作的印制电路板。	无线通讯、雷达等涉及无线信号收发应用的产品。
高速板	高速 PCB 指数字电路速率达到或超过 45MHz-50MHz，且这部分速率的信号占整个系统 1/3 以上。主要指采用高速覆铜板（通常指 $Dk \leq 4.0@1\text{GHz}$ ， $Df \leq 0.015@1\text{GHz}$ 的覆铜板材料）制造的印制电路板。该类印制电路板除常规的电气通断外，还对高速信号在印制电路板内的传输稳定性和完整性有了特定的要求。	有线通讯、网络设备、计算机/服务器等。

④按产品用途分类：通讯用板、消费电子用板、计算机用板、AI 算力/数据中心用板、汽车电子用板、军事/航天航空用板、工业控制用板及医疗用板等。

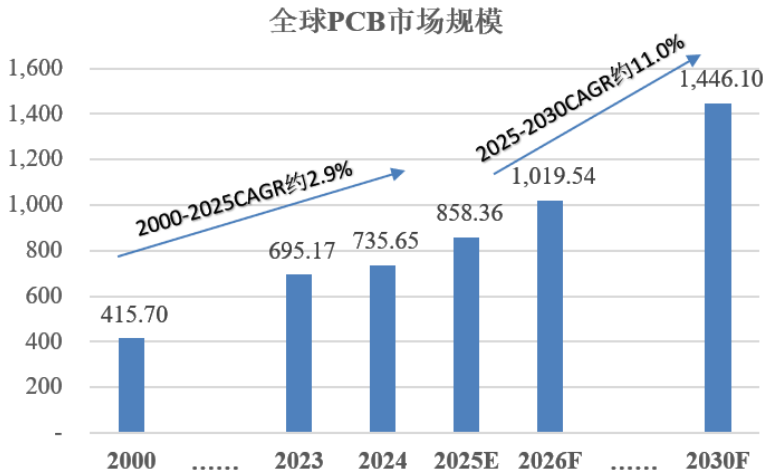
2、行业市场容量

(1) 全球 PCB 市场规模

随着下游人工智能、光通信、云计算、物联网、可穿戴设备、智能家居等新兴领域的蓬勃发展,PCB 行业正迎来新一轮结构性发展机遇。Prismark 数据显示,2025 年全球 PCB 市场规模达 858.36 亿美元,同比增长 16.68%,增长主要由 AI 基础设施建设、高速网络升级及卫星通信需求驱动。Prismark 预测,2025 年至 2030 年全球 PCB 市场产值将以 11.00%的年复合增长率持续成长,到 2030 年将达到 1,446.10 亿美元,其中,服务器及数据存储领域、有线通信领域的需求增速最为突出。

根据 Prismark 预测,2025 年至 2030 年全球 PCB 市场规模变化趋势如下:

单位：亿美元



数据来源：Prismark，2026 年 6 月

(2) 全球 PCB 分区域市场规模

从全球市场来看，PCB 行业主要分布在东亚和欧美地区，随着近些年来全球 PCB 产能逐步向中国大陆转移，中国大陆已经成为全球 PCB 产量最大的区域。根据 Prismark 预测，未来 5 年，亚洲将继续主导全球 PCB 市场的发展，而中国大陆位居亚洲市场不可动摇的中心地位。

根据 Prismark 预测，2025 年至 2030 年全球 PCB 分地区市场规模变化趋势如下：

单位：百万美元

地区	2000 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2030 年	2025-2030 年 平均复合增速
美洲	10,852	3,206	3,493	3,796	4,159	5,081	6.0%
欧洲	6,702	1,728	1,638	1,774	2,094	2,496	7.1%
日本	11,924	6,078	5,840	6,499	7,747	10,507	10.1%
中国大陆	3,368	37,794	41,213	49,652	58,781	81,764	10.5%
其他	8,724	20,710	21,381	24,115	29,173	44,762	13.2%
合计	41,570	69,517	73,565	85,836	101,954	144,611	11.0%

数据来源：Prismark，2026 年 6 月

(3) 全球 PCB 分产品市场规模

全球 PCB 细分市场主要集中在多层板、HDI 板、FPC 板等主要产品类型。根据 Prismark 数据，2025 年多层板、HDI 板、FPC 板市场规模分别约为 334.05 亿美元、161.97 亿美元、129.03 亿美元，市场份额分别约为 38.9%、18.9%、15.0%。

在 AI 基础设施需求快速扩张的背景下，行业正加速向高端技术方向发展。高阶 HDI、高多层板等 AI 算力领域相关品类的技术要求和资本投入要求持续提升，头部 PCB 企业将在这一轮结构性机遇中进一步扩大市场份额，行业“大型化、集中化、高密度化、高性能化”的趋势将在高端品类中率先实现。Prismark 预测，2025-2030 年 HDI 板、多层板市场复合增长率分别为 13.1%、11.9%，高于行业整体 11.0% 的增速。

（4）全球 PCB 分下游应用市场规模

根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 应用领域中，服务器及数据存储领域市场规模达到 160.31 亿美元，占比约 18.7%，超过移动电话成为最大的应用领域；移动电话领域市场规模达 150.46 亿美元，占比约 17.5%；计算机、汽车电子、消费电子分列其后，占比分别约为 11.9%、11.3%及 11.0%。

Prismark 预测，2025 年至 2030 年，服务器及数据存储领域将以 24.8% 的复合增长率成为增速最快的下游应用方向，核心驱动力为 AI 数据中心资本开支的持续扩张；有线基础设施以 19.0% 的复合增长率位居第二；移动电话、计算机和消费电子领域复合增长率分别约 4.5%、2.9%、3.7%，增速趋于平稳。

（5）全球 AI PCB 市场规模

1) AI 应用快速发展迭代下，科技大厂持续加大 AI 基础设施投入，AI 服务器市场景气上行

2022 年 11 月，ChatGPT 发布，并在短短两个月内突破 1 亿月活，正式开启生成式 AI 普及与商业化进程。2023 年至 2024 年，OpenAI、Google、Meta 陆续发布和迭代大模型，GPT-4、Gemini、Llama 等大模型相继面世，多模态交互、深度推理技术日趋成熟。2025 年，DeepSeek-R1 以高性能、低成本开源方案推动 AI 技术普惠；GPT-5、Gemini 3.0 迭代升级，模型自主规划能力大幅进步，全球智能体研发热度全面攀升。2026 年，以 Claude Code、OpenClaw 为代表的 AI Agent 类产品加速推动 AI 从被动问答工具向具备任务规划、工具调用和流程执行能力的生产力平台演进，企业级 AI 应用进入规模化落地阶段。

商业化价值持续兑现之下，全球科技大厂纷纷加码 AI 资本开支，驱动 AI 产业发展进一步提速，AI 服务器市场需求快速增加。未来随着 AI Agent 逐渐普

及、企业业务 workflows 智能化改造推进，AI 推理需求将带动全球算力消耗持续增加，AI 服务器市场需求仍处于景气上行早期。根据高盛 2026 年 6 月发布的研究报告，全球 AI 服务器市场规模预计从 2025 年 1,951 亿美元增长至 2030 年 12,436 亿美元，增量市场规模为 10,485 亿美元。

2) PCB 作为 AI 算力系统的“神经中枢”呈现量价齐升，整体市场规模快速扩张

AI 服务器整机出货量保持高速增长，直接带动 PCB 整体需求量持续扩容。同时，AI 服务器搭载多颗 GPU 芯片，内部算力板卡、高速互联背板等数量大幅增加，单台设备 PCB 用量数倍于传统服务器，叠加数据中心交换机、光模块等配套硬件需求，AI 算力领域对 PCB 产品的需求显著扩容。

此外，大模型训练和推理集群逐渐从数千颗 GPU/XPU 扩展至数万乃至数十万颗，数据中心内部需要在更短时间内完成更大规模的参数同步、梯度交换和推理数据流转，网络互连逐渐从“配套资源”转变为影响算力利用率的关键瓶颈，PCB 作为算力系统的“神经中枢”的性能要求越来越高，单位价值呈现显著提升。

在此背景下，全球 AI PCB 市场呈现量价齐升，整体市场规模快速扩张。根据 Prismark 数据，全球 PCB 市场规模将从 2025 年的 858.36 亿美元增长至 2030 年的 1,446.10 亿美元，市场规模增量为 587.74 亿美元；其中全球 HDI 市场规模将从 2025 年的 161.97 亿美元增长至 2030 年的 300.10 亿美元，市场规模增量为 138.13 亿美元。

根据高盛 2026 年 8 月发布的研究报告，2026-2028 年全球 AI 服务器 PCB 市场规模有望达到 135.60 亿美元、375.29 亿美元、836.45 亿美元，各年增长率为 172.23%、176.76%、122.88%。

3、行业发展趋势

(1) AI 推理及端侧应用的持续渗透推动 PCB 市场需求扩容

目前，AI 应用渗透仍处于早期阶段。随着生成式 AI 从模型训练走向推理，AI 应用逐步向企业智能化 workflows、AI Agent 以及端侧 AI 设备渗透，算力需求正由训练端向推理端持续扩展，推动 AI 服务器市场保持较高景气度，进一步扩大

AI PCB 市场空间。

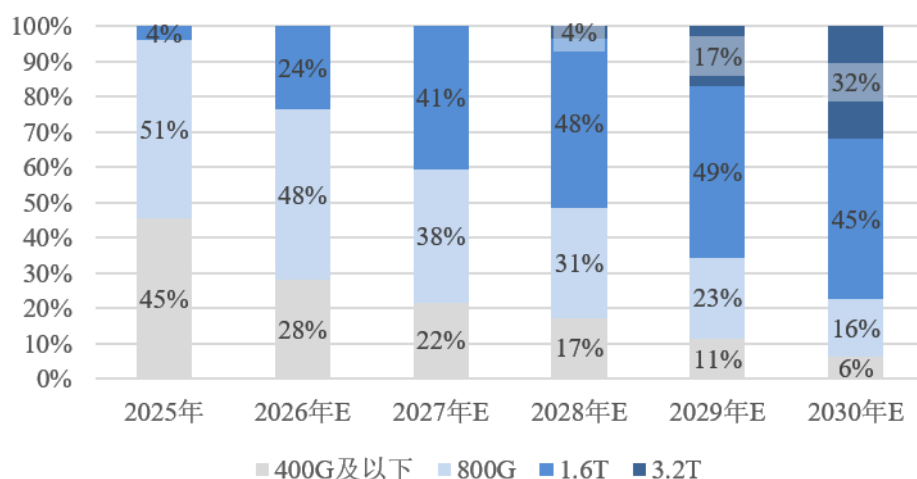
与此同时，AI 服务器供应链正呈现多元化趋势。AI 服务器平台升级带来的 PCB 价值量提升以及交付复杂度增加，导致全球头部客户逐步扩大 PCB 供应商池，以分散产能、交付和良率压力。在开放的 AI PCB 供应链体系下，具备高阶 PCB 制造能力的供应商有望获取新增份额。

除 GPU 服务器外，云厂商自研 ASIC 服务器正在成为 AI 算力基础设施的重要增量方向。ASIC 针对特定计算任务设计，在明确、稳定的大规模推理场景下通常具备更优的性能功耗比和单位算力成本优势。随着 AI 应用逐步由训练端向推理端扩展，Google TPU、AWS Trainium 等自研 ASIC 平台渗透率有望持续提升，推动 AI PCB 需求由 GPU 服务器进一步扩展至 ASIC 服务器。

（2）高速光模块代际升级推动 mSAP 工艺应用拓展并开启 AI 硬件新空间

AI 算力集群扩张导致数据中心高速互联需求快速提升，驱动光模块从 800G 向 1.6T 乃至 3.2T 快速代际升级。根据 Light Counting 数据，2026 年全球 800G 以上速率光模块占比将达 72%，2030 年进一步升至 94%。随着光模块速率不断提升，电信号在 PCB 中的传输频率持续提高，对 PCB 的传输损耗、信号完整性、布线密度以及阻抗控制提出更高要求，推动高速光模块 PCB 向高精度、高密度方向发展。

全球光模块分速率市场规模占比



数据来源：中际旭创招股书

mSAP（改良型半加成法）是一种用于制造 HDI 板及高端高速 PCB 的精细线路加工工艺，主要应用于高速光模块 PCB、AI 服务器 PCB 以及其他高密度互连

场景。相比传统工艺，mSAP 工艺可实现更精细的线宽线距，并具备更优的铜层均匀性和材料利用率，能够有效降低阻抗波动和信号传输损耗，更适用于 800G 及以上高速光模块等高频高速应用场景。随着光模块向更高速率演进，采用 mSAP 工艺制造的高端 HDI PCB 有望成为高速光模块的重要配套产品，相关 PCB 产品有望实现需求增长与单板价值量提升。

除高速光模块外，mSAP 工艺应用空间有望进一步向 AI 服务器等高密度互连场景拓展。随着 AI 服务器由单机板卡向整柜级、集群级架构演进，GPU、ASIC、Switch、网卡以及光电互连模块之间的数据传输需求持续提升，服务器内部高速互连板对于更细线宽线距、更高布线密度以及更严格阻抗控制的需求不断增强，未来部分高端 HDI 板、交换板及互连板产品有望向 mSAP 工艺方向升级。

同时，AI 芯片封装架构持续升级，CoWoP 等先进封装技术通过缩短信号传输路径、提升芯片与 PCB 之间互连效率，有望推动 PCB 由传统系统承载板向高精度 Platform PCB 方向演进。该类 PCB 产品对于精细线路加工、高层互连、低翘曲控制以及半导体级制造稳定性提出更高要求，而 mSAP 作为实现精细线路制造的重要工艺，有望进一步拓展应用空间。

（3）高阶 HDI 及 SLP 产品渗透率不断提升

智能手机、平板电脑以及可穿戴设备等电子产品向轻薄化、小型化以及多功能化方向发展的同时，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其对印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高。在这样的背景下，PCB 的线宽、线距、孔径、孔中心距以及层厚都在不断下降。HDI 能够实现更小的孔径、更细的线宽，节约 PCB 可布线面积、大幅度提高元器件密度、改善射频干扰/电磁波干扰/静电释放等，可以在满足终端电子产品性能及效率标准的前提下，实现更加小型化、轻薄化的设计。

伴随着 5G 跨 6G 的到来，下游高端电子产品在集成度和性能上提出了更高要求，对于 PCB 也延伸出新的技术迭代需求。SLP 相较于传统 HDI，进一步细化线路，线宽线距更小，堆叠层数更多，可以承载更多的功能模组，且图形精细化程度及可靠性均可满足高端产品的需求，是印制电路板行业生产制造技术在性能上向高密度、高精度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、高速传输、轻量、薄型方向的进一步发展。随着全球头部消费电子品牌厂商持续推进旗舰机

型主板升级，以及 AI PC、AI 智能手机对主板集成密度要求的持续提升，SLP 渗透率有望进一步扩大。

电子产品的持续更新换代支撑着 HDI 板市场规模的稳健增长。根据 Prismark 2026 年 6 月数据，2025 年全球移动电话领域 HDI 板市场规模约 64.56 亿美元，PC 和其他消费电子领域 HDI 板合计约 33.66 亿美元，相关领域合计占 HDI 板市场比重为 60.64%。2025-2030 年，移动电话、PC、其他消费电子领域 HDI 板复合增长率分别约为 4.2%、2.9%和 5.9%，保持稳健增长。

（4）高精度工艺推动产业智能化升级

随着 AI 算力、高速通信等下游行业技术迭代持续加快，终端硬件产品向高速化、小型化、高密度化方向升级，推动配套 PCB 向高频高速、高密度化发展。算力领域用 PCB 产品加工工艺严苛、生产难度大、技术壁垒高，不仅需要高精度生产设备，更需要智能化制造管控体系来保障产品良率和交付稳定性。PCB 行业正加速向自动化、数字化、智能化方向升级，通过建设高规格智能化产线，引入先进生产及检测设备，强化在精细线路、层间对位、阻抗控制、信号完整性、良率管理等方面的制造能力，以提升高端产品交付稳定性和成本竞争力。具备智能制造能力的头部企业将在高端 PCB 市场竞争中获得显著优势。

（5）PCB 行业技术门槛提升推动市场向头部企业集中

未来随着服务器等领域应用产品性能持续升级，PCB 从传统的“电子之母”转变为电子产品的“神经中枢”，其在电子产品中的重要性进一步提升，技术实力、生产能力无法满足要求的中小厂商预计无法获取增量市场份额，整体市场格局将向综合实力较强的头部厂商集中。

例如，目前高端服务器 PCB 正在由 4 阶、5 阶 HDI 向 6 阶 HDI 演进，6 阶 HDI 已成为下一代高端 GPU 服务器关键板卡的重要先进方向。而缺乏技术沉淀的中小厂商目前不具备 6 阶及以上 HDI 的量产能力，且高阶 HDI 产品涉及复杂工艺积累、长期客户验证及较高生产良率要求，短时间内难以完成技术追赶。因此，具备高阶 PCB 技术储备、规模化量产能力及客户认证优势的头部厂商将在行业竞争中占据更有利地位。

4、行业的利润水平及变动趋势

从企业外部看，PCB 行业的利润水平主要取决于两方面：一是上游供给，PCB 行业上游原材料的采购价格决定了企业的材料成本。PCB 行业的利润水平受上游原材料价格波动影响较大。电子零件、铜箔、铜球、铜箔基板、半固化片、油墨、干膜和金盐等产品是 PCB 生产所需的主要原材料。其中，电子零件、铜箔基板对 PCB 的成本影响较大。二是下游需求，下游终端产品的市场需求将最终决定 PCB 行业的整体营收水平。PCB 下游行业分布广泛，产品应用领域不断扩展，市场更趋多元化，下游行业市场需求变化将直接影响 PCB 产品的营收水平。

从企业内部来看，由于 PCB 产品细分类型多、应用领域广、生产定制化等特征，PCB 行业的销售利润水平因企业自身定位、客户结构、主营产品结构及管理能力等方面的差异而会有很大不同。从产品类型和技术水平来看，HDI、SLP 等产品由于技术难度高、需求增长快，利润水平较普通产品高。对规模庞大的 PCB 生产商来说，产品良率是影响公司盈利能力的至关重要的因素，而稳定高良率很大程度依赖于公司健全的管理体系和高效的管理水平。此外，综合技术实力强的企业可以通过精准定位、优化设计、工艺改造等科学方法，提高生产效率，降低生产成本，提升利润水平。

近年来，下游行业对 PCB 产品的品质和性能不断提出新的要求。得益于国家对电子信息产业的政策支持，中高端产品的市场需求呈现迅速增长的发展趋势，PCB 行业未来发展前景广阔。尽管行业竞争激烈，但由于行业进入门槛总体而言正不断提高，行业领先者仍将保持快速、良性发展态势。行业利润水平将在保持相对稳定的基础上，通过不断提高产品技术水平、扩大生产规模、提高生产效率及自动化水平而得到逐步提升。

（四）行业特点

1、行业竞争格局及行业内主要企业

（1）行业竞争格局

全球 PCB 生产企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分。根据 Prismark 数据，2025 年全球前十大 PCB 厂商收入占全球市场规模 37.74%。未来随着服务

器等领域应用产品性能持续升级，具备高阶 PCB 技术储备、规模化量产能力及客户认证优势的头部厂商将在行业竞争中占据更有利地位，整体市场格局将向综合实力较强的头部厂商集中。

根据 2025 年 Prismark 数据及公司营业收入测算，鹏鼎控股的市场占有率位居全球印制电路板厂商第一。从产业布局来看，亚洲地区在全球 PCB 产业中占据主导地位。在 Prismark 发布的 2025 年全球百强 PCB 企业中，91 家企业总部位于亚洲，其中总部位于中国大陆的企业有 43 家。中国大陆 PCB 产值增速较快，且中国大陆目前是全球最大的 PCB 生产基地，产值占比超过 50%。

（2）行业内主要企业

①东山精密

东山精密成立于 1998 年，总部位于江苏省苏州市，2010 年在深圳证券交易所上市。东山精密从事 PCB、精密组件、光模块、光电显示模组等业务，PCB 业务主要包括 FPC、柔性电路组件（FPCA）、HDI、刚挠结合板等产品，主要应用于消费电子、通信及汽车电子等领域。

②深南电路

深南电路成立于 1984 年，总部位于广东省深圳市，2017 年在深圳证券交易所上市。深南电路从事 PCB、封装基板及电子装联业务，其中 PCB 产品包括背板、高多层板、HDI、射频板及刚挠结合板等，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子及航空航天等领域。

③迅达科技

迅达科技（TTM Technologies, Inc.）成立于 1998 年，总部位于美国加利福尼亚州，2000 年在纳斯达克上市。迅达科技 PCB 产品包括传统多层板、HDI 及 Ultra-HDI、FPC、刚挠结合板、背板及类载板等，主要应用于数据中心及计算、通信、汽车、医疗、工业以及航空航天和国防等领域。

④沪电股份

沪电股份成立于 1992 年，总部位于江苏省昆山市，2010 年在深圳证券交易所上市。沪电股份主要 PCB 产品以高多层、高频高速及 HDI 等中高端产品为主，

主要应用于通信设备、AI 服务器及数据中心、汽车电子等领域。

⑤胜宏科技

胜宏科技成立于 2006 年，总部位于广东省惠州市，2015 年在深圳证券交易所创业板上市，并于 2026 年在香港联交所主板上市。胜宏科技主要从事高精密多层板、高阶 HDI、FPC 及刚挠结合板等产品的研发、生产和销售，主要应用于 AI 及高性能计算、数据中心、网络通信、汽车电子和智能终端等领域。

⑥华通电脑

华通电脑成立于 1973 年，总部位于中国台湾桃园市，1990 年在中国台湾证券交易所上市。华通电脑 PCB 产品包括多层板、HDI、FPC、刚挠结合板等，主要应用于手机、计算机、服务器、通信及消费电子等领域，并在中国台湾及中国大陆惠州、苏州、重庆等地布局生产基地。

⑦健鼎科技

健鼎科技成立于 1991 年，总部位于中国台湾桃园市，2002 年在中国台湾证券交易所上市。公司 PCB 产品以双面板及多层板等为主，主要应用于服务器、存储设备及内存模组、汽车电子、显示设备、通信及消费电子等领域。

⑧日本旗胜（Nippon Mektron）

日本旗胜（Nippon Mektron）成立于 1969 年，总部位于日本，是 NOK 集团旗下全球主要柔性电路板厂商，2024 年由 Nippon Mektron 更名为 MEKTEC Corporation。公司主要从事 FPC、柔性电路组件（FPCA）及相关模组产品的研发和生产，产品主要应用于智能手机、汽车、可穿戴及医疗等领域。

2、影响行业发展的有利和不利因素

（1）影响行业发展的有利因素

①国家产业政策的持续大力支持，引导 PCB 产业健康发展

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，PCB 行业是电子信息产业中不可或缺的组成部分，受到国家产业政策的大力支持。2023 年 12 月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，将高频高速印制电路板、特种印制电路板等继续列为鼓励类产业；2025 年 12 月，国

家发改委、商务部联合发布《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》，明确将“高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板、高密度高细线路(线宽/线距 $\leq 0.05\text{mm}$)柔性电路板”列入鼓励外商投资产业目录。

目前国内出台的一系列鼓励 PCB 产业发展的积极政策，将引导 PCB 产业步入健康发展的轨道。

②电子信息行业迅速发展，新型应用领域不断发展，带动 PCB 产业快速增长

近年来，以大模型为代表的人工智能技术加速落地，驱动全球 AI 基础设施建设进入爆发期，AI 数据中心对高阶 HDI 板及高多层板的需求大幅攀升，成为当前 PCB 行业最重要的结构性增长驱动力。

根据 Prismark 2026 年 6 月数据，2025 年全球 PCB 市场规模达 858.36 亿美元，同比增长 16.7%，预计 2026 年进一步增至 1,019.54 亿美元，2025 年至 2030 年复合增长率为 11.0%。其中，服务器及数据存储领域 PCB 以 24.8%的复合增长率成为增速最快的下游应用方向，核心驱动力为全球 AI 数据中心资本开支的持续扩张；有线基础设施以 19.0%的复合增长率位居第二。Prismark 判断，AI 基础设施需求正驱动 PCB 市场从消费者驱动向基础设施驱动加速转型，高阶 HDI、高多层板等高端品类将持续保持显著高于行业整体的增速。

③PCB 行业智能制造、工业自动化、数字化水平持续提升

PCB 生产涉及的工业制程复杂、工序繁多、技术要求严格，工业自动化的迅速发展，使得生产制程自动化程度越来越高，可以有效提高生产效率、产品良率，并降低人工成本，最终转化为公司利润。《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提出，应坚持以人工智能等新一代数智技术与制造业全链条深度融合为主线，深化实施智能制造工程，大力推进“人工智能+制造”专项行动，加快制造业数字化转型、网络化协同、智能化跃升，统筹推进智能化、绿色化、融合化升级，加快培育新质生产力，赋能新型工业化，为推动制造业高质量发展、建设制造强国与数字中国、塑造国际竞争新优势提供坚实保障。

（2）影响行业发展的不利因素

①原材料价格波动与高端材料供给瓶颈

PCB 生产所需的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜及油墨等，直接材料在生产成本中占比较高。其中，覆铜板价格受铜箔、电子玻纤布及树脂等上游材料价格影响；铜球、金盐等材料价格则与铜、黄金等金属价格密切相关。

相关原材料价格受到国际地缘政治、全球通胀、大宗商品价格及市场供需关系等因素影响。与此同时，AI 服务器、高速交换机等算力基础设施需求快速增长，带动高多层、高频高速 PCB 以及高性能覆铜板、低介电电子布、超低轮廓铜箔和特种树脂等材料需求增加。由于高端材料技术壁垒较高、产能建设计划周期偏长，短期供给弹性相对有限，可能进一步加剧相关原材料的结构性供需紧张和价格上涨压力。

②环保要求不断提升

随着国家不断颁布实施严格的环保法规，企业环保成本持续上升。2026 年 3 月，国务院在政府工作报告中介绍《“十五五”规划纲要（草案）》主要目标指标，其中绿色低碳方面围绕降碳减污、生态环保等提出 5 项指标，根据国家自主贡献目标，“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低 17%，并明确实施碳排放总量和强度双控制度，继续推动重点领域绿色低碳转型。

3、进入本行业的主要障碍

（1）资金壁垒

印制电路板行业的资金壁垒主要体现在以下几个方面：

①项目建设成本高。印制电路板生产线及相关配套设备的投入成本较高，印制电路板行业的前期投入金额较大，生产厂商必须具备较强的资金实力。

②持续投入大。为保持产品的持续竞争力，厂商必须不断对生产设备及工艺进行升级改造，并保持较高的研发投入，以紧跟行业更迭步伐。

③定制化生产成本高。PCB 生产中的显著特点即定制化生产，大型 PCB 厂商为不同客户或者同一客户的不同产品需求制定不同的生产计划、选用不同的生产设备，更凸显了资金实力在企业发展中的基础作用。

④快速供货和交付能力要求高。PCB 生产商需要在下游客户的生产集中地

区建厂布局，以提升快速供货和交付能力。在不同地区选址建厂的巨额资本投入加大了对厂商资金实力的考验。

PCB 行业作为资本密集型行业，其前期投入和持续经营对于企业资金实力的要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。

（2）技术壁垒

印制电路板是一个市场细分复杂的行业，不同的印制电路板虽有一些共同的基本工艺，但更重要的是根据基材厚度和材质、要求的线宽和线距大小、精度、PCB 的结构、生产规模、装连工艺及客户指定需求等，结合生产企业的特色工艺和服务各种类型客户的经验，确定不同的生产工艺和设备，进行定制化的生产和服务。

PCB 产品类型丰富繁杂，刚性板、柔性板、HDI 等虽然在工艺上有共通点，但是在具体生产中，各类型产品都有自己一套独立的生产体系，这也往往是一些中小厂商集中生产某个类型 PCB 产品的原因，无法达到大型厂商可以满足下游客户“一站式采购”的水平。

随着电子产品日益朝智能化、轻薄化、精密化方向发展，其对于 PCB 产品的技术先进性及稳定性要求日益提高，这意味着生产企业必须拥有先进的生产设备、精湛的生产工艺及不断创新的生产技术，进入 PCB 行业的技术壁垒亦将日益提高。

（3）客户认可壁垒

印制电路板是电子产品的基础组件，其质量好坏直接关系到电子产品的功能和寿命。因此，印制电路板的下游客户、尤其是优质的大型客户，对印制电路板品质的要求较高。业内一般采用“合格供应商认证制度”，要求 PCB 生产商具有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品牌声誉。尤其是一些国际领先品牌客户，遴选合格供应商时不仅关注产品性能、质量和稳定性等，还包括稽核程序、“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理、工厂作业规范、生产程序、环保、员工福利和社会责任等众多软性考核指标，认证程序严格复杂，耗时较长。

通过合格供应商认证后，涉及具体型号的产品生产时，下游客户往往需要

PCB 厂商参与共同研发，客户会对供应商提出的几个甚至数十个方案进行反复论证。因此，PCB 生产商的共同设计研发能力对客户形成了一定的绑定效果，客户黏性较强。总体而言，优质的下游高端客户倾向于与大型 PCB 生产企业合作，其对 PCB 供应商的考察周期较长，一旦形成长期稳定的合作关系，不会轻易启用新厂商进行合作，从而形成较高的客户认可壁垒。

4、行业的经营特征

（1）周期性

PCB 行业的周期性受宏观经济波动的影响。随着电子信息产业的不断发展，PCB 行业下游应用领域越来越广泛，涉及通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、服务器、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等众多领域。总体而言，PCB 行业受单个行业波动影响较小，宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况的影响较大。

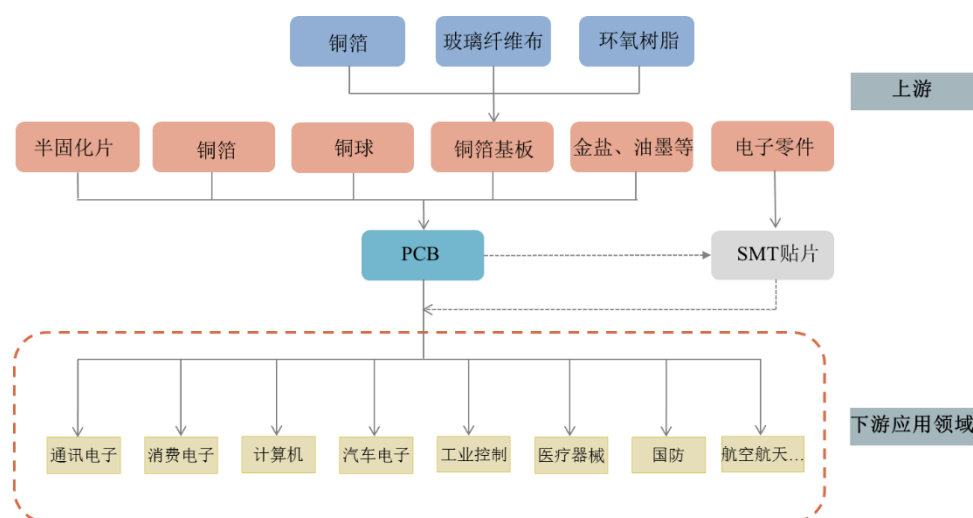
（2）季节性

PCB 行业的季节性受下游应用领域的季节性影响。公司主要的产品以手机、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑等通讯电子、消费电子领域为主，该等产品需求受节假日及人们消费习惯的影响呈现出一定的季节性，一般上半年为产品销售淡季，下半年为产品销售旺季。PCB 行业的生产旺季通常稍早于下游产品的销售旺季。

算力领域 PCB 产品的采购节奏更多受下游客户资本开支计划和芯片迭代周期影响，季节性特征相对较弱。

5、上下游行业之间的关联性及影响

PCB 行业与上下游行业之间的关系如下图所示：



（1）与上游行业之间的关系

制作 PCB 的上游原材料主要为铜箔、铜球、铜箔基板、半固化片、油墨、干膜和金盐等；此外，为满足下游领先品牌客户的采购需求，许多情况下 PCB 生产企业还需要采购电子零件与 PCB 产品进行贴装后销售。铜箔基板系 PCB 空板中最为主要的原材料，对 PCB 的成本影响较大，其制造涉及玻纤纱制造、玻纤布纺织、铜箔制造等上游行业。

（2）与下游行业之间的关系

PCB 的下游应用领域较为广泛，近年来下游行业更趋多元化，产品应用覆盖通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、服务器、光模块、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等各个领域。本行业与下游行业的发展相互关联、相互促进。一方面，PCB 下游行业良好的发展势头为 PCB 产业的成长奠定了基础，下游行业对 PCB 产品的高系统集成、高性能化不断提出更严格的要求；另一方面，PCB 行业的技术革新为下游行业产品的推陈出新提供了可能性，从而进一步满足终端市场需求。

（五）发行人出口业务情况

报告期内，公司营业收入按区域划分主要构成如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
美国	1,235,854.30	71.78	3,123,566.79	79.79	2,888,485.28	82.20	2,587,428.69	80.69

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
大中华地区	346,978.29	20.15	652,204.05	16.66	511,111.84	14.54	501,074.94	15.63
亚洲其他	128,400.19	7.46	123,953.97	3.17	109,094.14	3.10	116,243.32	3.63
欧洲	10,484.38	0.61	14,976.13	0.38	5,347.18	0.15	1,857.83	0.06
合计	1,721,717.15	100.00	3,914,700.94	100.00	3,514,038.45	100.00	3,206,604.78	100.00

公司根据其直接下单主体的注册地，对营业收入按地域进行了划分。报告期内，公司客户主要来自美国及大中华地区，上述两个区域销售收入合计占比达 90%以上。

（六）发行人的行业地位及核心竞争力

1、发行人的行业地位和市场占有率

公司连续多年位列中国电子电路协会（CPCA）中国电子电路排行榜第一。根据 Prismark 以营收计算的全球 PCB 企业排名，公司 2017 年-2025 年连续九年位列全球最大 PCB 生产企业。

2、发行人核心竞争力

（1）产品优势：打造全方位的 PCB 产品一站式服务平台

公司为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商，拥有优质多样的 PCB 产品线，主要产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车/服务器等产品，具备为不同客户提供全方位 PCB 产品及服务的强大实力，打造了全方位的 PCB 产品一站式服务平台。

公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力、完善的品质保障能力，能够为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略，以及卓越的及时响应、大批量供货能力，全球头部品牌客户与公司保持长期的业务合作。

（2）客户优势：服务国际领先品牌客户及电子代工企业

电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”，要求 PCB 生产商具有健全的运营网络、高效的信息化管理系统、丰富的行业经验和良好的品

牌声誉。尤其是一些国际领先品牌客户，遴选合格供应商时不仅关注产品质量等生产指标，还要求供应商接受其严格的稽核程序并满足诸如“6S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）管理、工厂作业规范、生产程序、环保、员工福利和社会责任等众多软性考核指标。凭借自身领先的研发实力、大批量供货并及时交付的能力、优质稳定的产品质量以及卓越的企业管理水平、完善的环保布局、良好的社会形象，公司已成功进入众多国际领先品牌客户的合格供应商体系。

公司深耕 PCB 行业多年，专注于为电子信息行业的国际头部客户提供定制化的高端 PCB 产品方案。自公司成立以来，持续与全球领先的电子品牌客户合作。在长期服务头部客户的过程中，公司打造了领先的高效运营体系，具备较强的产品设计与研发实力、大批量供货能力，产品质量稳定性突出。公司已形成为下游客户提供短时间内快速设计、开发制样到快速爬坡（Ramp-up）、大量生产的服务能力，协助客户缩短产品上市时间并赢得市场先机，即协助客户建立“Time to Market + Time to Volume + Time to Money/Market share”的成功营运模式。因此，头部客户通常选择与公司合作以满足其电子产品对高端 PCB 方案的需求，公司与下游头部客户进而形成了紧密深入的合作关系，共同开发行业领先的电子产品。

依托于运营体系与综合能力，公司目前已经向算力领域的全球头部客户实现量产出货。未来公司有望充分把握算力领域市场快速扩容、PCB 技术不断迭代的行业机会，持续提升头部客户的覆盖和供应份额。

（3）技术优势：参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿

公司持续专注并深耕电子电路领域产品技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达 0.025mm、最小线宽可达 0.020mm，公司在高频与射频通信模组、高速传输与信号完整性模组、动态弯折与轻薄化、高阶摄像模组、车载与储能、太空通讯、高性能计算机、1.6T/3.2T 光模块、服务器用高阶 HDI 产品、嵌入式组件高阶硬板、新一代框架板等产品领域，均已实现产品开发与制程建立，具备产业化能力。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 2,872 件，累计获证 1,744 件。公司及子公司宏启胜、庆鼎精密均取得知识产权贯标，并已被认定为高新技术企业，2023 年公司被认定为国家企业技术中心。

公司同步与国际品牌客户展开未来 1~2 年产品开发与技术布局，亦提前展开新材料应用研究、新制程技术攻关、新产品品质验证、智慧制造产线建设等技术储备，在新一代电子信息产业领域中，公司不断深耕在人工智能、5G & 6G 通讯、多元微型显示、新能源、折叠显示、汽车电子、消费电子、网通基站、光通讯、低轨卫星、AI 服务器、能源存储、机器人、智慧医疗、可穿戴设备、脑机接口等领域的产品研发方向上布局，围绕新产品、新技术、新制程、新材料和新设备五大主轴，全力聚焦关键共性技术与产品前沿技术，以掌握产品发展的潮流与趋势。

在精细线路方面，公司具有较为突出的技术优势和量产优势。公司早在行业发展初期便深耕 HDI、SLP 等高精密 PCB 技术，自 2017 年起布局 mSAP 技术，并在消费电子领域实现规模化量产，具备微米级线宽线距加工能力。凭借在消费电子领域的长期积累，公司在精细线路大规模量产方面具备深厚的技术沉淀、丰富的制造经验和人才储备，产品良率、品质在行业内均处于领先地位。近年来，公司已将相关工艺逐步应用于算力领域产品，并针对算力领域产品生产制造过程的特殊工艺进行开发，相关产品已向全球头部客户量产出货，完成了 HDI 产品制造的跨领域迁移。公司在消费电子领域积累了丰富的 HDI 产品量产经验，有助于缩短算力领域 HDI 产品的产能爬坡周期、提高生产稳定性，能够较好地保障下游客户的交付周期和交付质量要求。

（4）管理优势：优秀的经营理念及经验丰富的管理团队

多年来，公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，致力于“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景，将“诚信、责任、创新、卓越、利人”作为核心价值观贯彻于企业经营的各个方面。与时俱进的经营理念，增强了公司管理团队的凝聚力、向心力及执行力，不仅使公司建立起追求卓越、以人为本、绿色发展的企业文化和企业价值观，也使公司取得了客户、合作伙伴及社会各界的广泛认同。

公司拥有一支经验丰富、与时俱进的管理团队，包括具备海外学历的精英人才、具备深厚电子产业背景的行业人才、拥有大量研发成果的研发人才及精通投融资的金融人才等。公司经营团队具备丰富的行业管理经验，并具备国际化视野，主要产品事业处主管具有多年相关实务运营经验。针对中高层及核心骨干员工，

公司实施了股权激励计划及人才养成晋任计划，定期举办领导力培训课程以提升公司管理阶层的领导能力，搭配双轨制、晋升牵引与奖励薪酬机制等措施，以发挥管理层最大效能。

（5）环保优势：完善及富有前瞻性的环保布局

公司高度重视内部绿色文化建设，推动“鹏鼎七绿”理念：绿色创新、绿色采购、绿色生产、绿色运筹、绿色服务、绿色再生和绿色生活，进一步创造绿色价值，积极履行企业社会责任。公司设立有环保节能专责部门（环保节能处），发展污染防治、资源回收、循环经济及节能减排等自有绿色技术，时刻关注绿色环保及节能减排最新趋势，积极推行温室气体盘查及清洁生产审查。公司自成立伊始即已就各园区环保设施建设进行了提前规划，重视在环保方面资金的持续投入。公司注重节能减排工作的持续开展，将污染防治及资源再生作为永续发展的基石，建立了新环保标准示范生产基地，废水依水质特性详细分为 20-25 类，废弃物分为 69 类以上，污染物排放均达到或者优于政府管制标准，废弃物资源化比例达 90%以上。

公司各园区多次获评当地绿牌及绿色企业，并于 2017 年及 2018 年相继获评工信部第一批、第二批全国“绿色工厂示范企业”。淮安第二园区及秦皇岛园区于 2020 年及 2021 年先后获得工信部“绿色制造企业之绿色供应链管理企业”荣誉。2025 年，各园区均持续通过“可持续水管理标准（AWS）”白金级认证以及废弃物零填埋 UL 2799 铂金级认证，深圳第一园区荣获工信部绿色供应链管理企业。同时，为配合国家“双碳目标”，公司制定了碳中和的长期规划，积极推进低碳运营，为科学减碳奠定基础。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主要产品及其用途

公司是主要从事各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务为一体的专业大型厂商，专注于为行业领先客户提供全方位 PCB 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 PCB 的定制化要求，为客户提供涵盖 PCB 产品研发、设计、制造与销售服务各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同，公司的 PCB 产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、汽车\服务器及其他用板等，产

品广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子、光模块等下游领域。

通讯用板主要包括应用于手机、通信卫星等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上，并以智能手机领域为主，满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。公司生产的通讯用板包括柔性印制电路板、刚性印制电路板、高密度连接板、类载板（SLP）等多类产品，服务的客户包括了全球领先电子品牌客户。

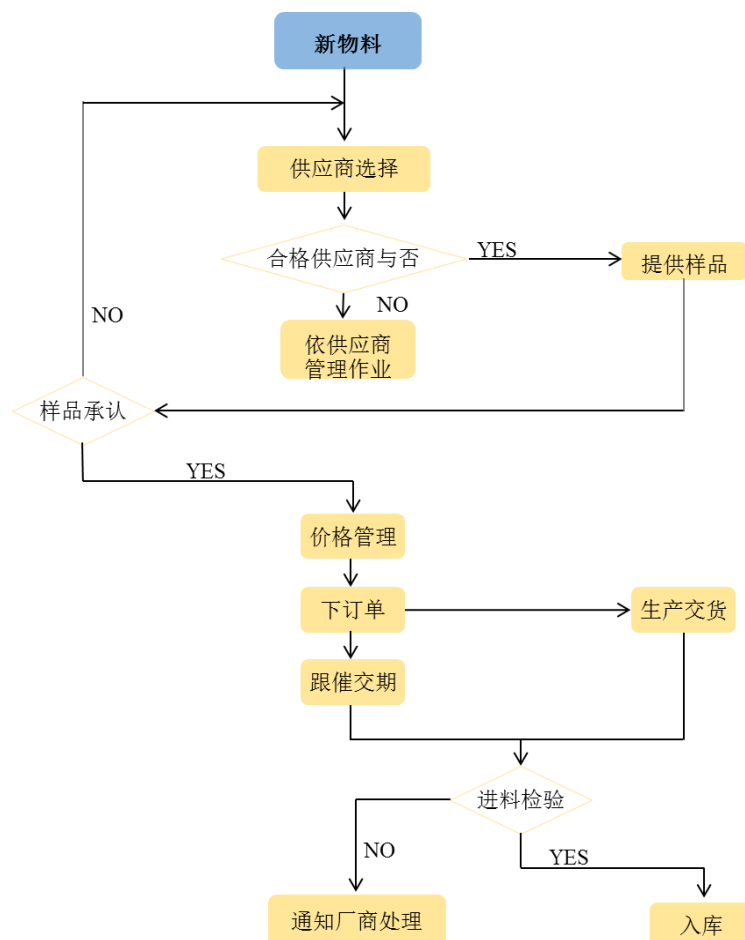
消费电子及计算机用板主要应用于计算机、平板电脑、可穿戴设备等 AI 终端消费电子产品，以及游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。

汽车/服务器及其他产品用板指主要应用于服务器、高速光模块、汽车等领域的 PCB 产品。公司近年来加快了对 AI 服务器和高速光模块等算力领域市场的开拓，相关产品已向全球头部客户量产出货。

报告期内，公司印制电路板产品整体产能利用率及产销率情况良好。

（二）主要业务经营模式

1、采购模式

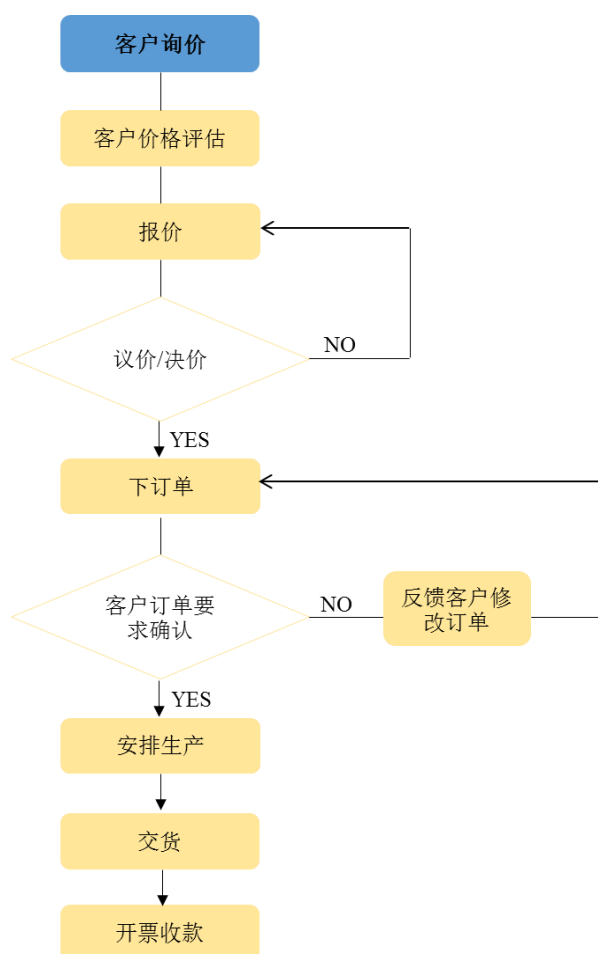


发行人建立了健全的供应商评价及选择体系，采购部根据研发、工程单位对新物料的需求，按照《供应商管理作业》筛选合格供应商。采购部通过询价、比价、议价后确认采购价格。物控部依据市场部门的销售预测和客户的实际订单提请采购单，由项目企划在合格供应商处实施采购。

2、生产模式

发行人建立了一套快速有效处理客户订单的流程，涵盖产能规划、生产排配、进度管控及交货管理作业等环节，保证多地工厂按计划生产、发货以满足客户需求。发行人基本实行以销定产的生产模式，绝大多数产品都实行定制化生产。

3、销售模式



发行人采取直接销售的模式，与全球领先品牌客户直接洽谈销售业务。业务处负责开发客户、维系客户、接收订单、出货管理、账款收回、技术服务等工作，可划分为市场销售部、产品客户服务部和技术服务部等；同时市场销售部又按客户结构及管理需求进行细分，最终形成矩阵式的销售架构，全方位服务客户。发行人的客户包括国际电子专业代工大厂（EMS）、品牌客户及其指定的原厂委托设计制造商（ODM/OEM）等。基于不同的交易模式，公司除与品牌客户合作关系密切外，与 EMS 及 ODM/OEM 厂商的合作关系亦相当紧密。

为满足部分下游客户高频率采购的需求，发行人与部分客户采用发货仓交货模式。在发货仓模式下，发行人根据客户订单生产出产品，将产成品运送至发货仓，通常委托物流公司对发货仓货物进行管理。客户根据需求领用产品后，发行人相应确认收入。

（三）主要原材料、能源情况

1、主要原材料

报告期内，公司采购的主要原材料包括电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等。2026 年以来，上游原材料市场整体供应偏紧，部分核心材料价格呈上涨趋势。公司通过与主要供应商建立长期合作关系、适度提前备货等方式，保障原材料供应的连续性和质量稳定性，能够满足当前生产所需。

2、能源

公司产品生产环节主要能源为电力，报告期内电力整体供应充足，能够满足公司生产经营需要。

（四）生产经营所需的主要生产设备、房屋情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值为 4,022,010.87 万元，固定资产账面价值为 1,770,982.57 万元，总体成新率为 44.03%，生产经营所需的主要生产设备、房屋处于完好状态，使用正常。公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

项目	期末余额	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
机器设备	2,117,286.66	1,294,582.05	3,027.64	819,676.97	38.71%
房屋建筑物	1,082,435.02	375,204.98	-	707,230.04	65.34%
计算机及电子设备	53,634.40	38,548.03	-	15,086.37	28.13%
土地	19,724.71	-	-	19,724.71	100.00%
运输工具	1,580.67	786.66	-	794.01	50.23%
其他设备	747,349.41	537,273.72	1,605.22	208,470.47	27.89%
合计	4,022,010.87	2,246,395.44	4,632.86	1,770,982.57	44.03%

（五）业务经营资质

发行人及其境内子公司获得境内政府机构颁发的主要经营资质及许可主要包括进出口货物收发货人备案、排污许可证、辐射安全许可证等。公司已经取得从事主要业务相关生产经营活动所必需的备案、注册或者认证等，可以开展相关业务和经营活动。

（六）核心技术来源

发行人持续专注并深耕电子电路领域产品技术研发，围绕新产品、新技术、新制程、新材料和新设备五大主轴，直接参与客户下一代、下下代产品的前瞻开发，通过与世界一流客户的协同研发、参与先期产品开发与设计从而掌握市场趋势及新产品商机，准确把握产品与技术研发方向。公司不仅致力于自身研发，还构建产、学、研合作的技术研发平台，并建立企业技术中心。2023 年，公司被认定为国家企业技术中心。公司与多所知名大学及研究院展开研究合作，推动创新项目，确保在技术创新和市场需求方面保持领先地位。同时，公司持续推动产业链战略伙伴交流合作，促进行业上下游的技术整合、工艺开发与制程运用，创建 PCB 技术平台，及时把握 PCB 前沿技术的发展方向。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 2,872 件，累计获证 1,744 件。公司及子公司宏启胜、庆鼎精密、无锡华阳均为高新技术企业。

五、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

1、研发策略及计划

公司以“发展科技，造福人类，精进环保，让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”的核心价值观，持续开发符合产品发展潮流与趋势的先进制程技术和前瞻产品技术；同时，拓展多元化产品线业务版图，不断提升公司竞争优势。

随着人工智能、6G 通讯、多元微型显示、新能源、折叠显示、第三与第四代半导体技术演进，汽车电子、消费电子、网通基站、光通讯、低轨卫星、AI 服务器、高带宽内存、能源存储、机器人、智慧医疗、可穿戴设备、脑机接口等领域快速更新迭代，这些新动能将引领行业未来发展。

因此，公司短期研发计划将积极布局 AI 云、管、端等高速成长的市场，如人工智能芯片附加电路板和大尺寸高多层附加电路板技术等 AI 关键产品技术，同时亦积极布局、开发具有未来潜力的产品技术。

2、生产经营计划

公司依据客户及产品类型制定年度销售策略：在产品布局方面，紧抓人工智能发展浪潮，持续完善 AI “云-管-端”全产业链条，重点提升 AI 服务器、高速光模块等核心产品的业务比重，实现云端协同共振；在客户拓展方面，深耕现有老客户老产品存量份额，挖掘老客户新产品的新增需求，同时积极开辟新客户新产品的增量赛道；在 “One Avary” 产品平台框架下，巩固 FPC 产品的既有优势，提升 HDI 及 mSAP 产品的市场份额，增强 HLC 产品竞争力，实现各产品线协同发展、优势互补，为客户提供 “一站式购物”（ONE-STOP SHOPPING）的完整解决方案。

在采购策略上，公司以 “善待供应商” 为核心理念，积极推动与战略伙伴的合作共赢，持续深化与更多关键供应商的战略合作联盟建设。面对瞬息万变的市场环境，不断优化采购决策流程，提升响应效率，切实保障公司供应链的安全与稳定。

在生产管理中，加强产品品质管理，进一步做好客户服务，继续推动智慧化生产，提高生产效率，持续通过 CAPDCA 落实改善，为客户提供卓越的产品和服务。

在经营管理上，将持续践行 “诚信、责任、创新、卓越、利人” 的核心价值观，秉持长期主义理念，致力于实现企业的永续发展。为此，公司将继续大力推动数字化转型，着力推动组织活性化，激发团队创新活力与协同效能，勇于突破与变革，确保公司长期战略目标的顺利实现。

3、财务策略

（1）保持合理的资金流动性及现金流水平，以保障企业营运安全；（2）为避免汇率波动风险，适当采用金融避险产品规避不确定性风险，以降低汇率影响；（3）科学规划长短期融资，合理调配境内外融资，开拓多样化融资渠道，有效降低融资成本和风险，提高资金使用效率。

4、人才培养计划

公司随时洞悉市场变化趋势，结合公司发展策略，根据业务需求和职能差异，努力聚焦人才核心能力，深耕企业组织文化，致力于培养未来人才，赋能海外业

务发展，助力战略目标达成，推动公司实现永续经营。为此，公司建立了系统化的人才培养体系，根据不同职级和专业方向，规划相应的人才发展计划，并有效整合内外部资源，有针对性地培育集团发展所需的各类核心人才。通过规划设计、执行落地、资源引进、体系优化及人才诊断等环节，构建出最有价值的人才供应链。

（1）选对人：健全各级人才培养选拔机制，做到适才适岗，精准聚焦培育，提升相应知识技能；（2）育得专：培养国际化、专业化、自动化、智能化多元人才，活用公司培训平台，精进专业类培训，由技术委员会及品保管理学苑，规划技术认证考核体系，结合公司产学外引内化培训，打造卓越的技术人才梯队；（3）用得好：推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好机制，推进接班人培养计划，实现级级传承的企业发展大计；（4）留得住：激活人才发展通道，为组织打造最有价值的人才供应链，提供优质资源及支持，助力稳步成长稳定发展；（5）发效能：加速人力资源数字化转型，持续优化人力资源工程，为企业决策提供人力数据支撑，实现人才提质增效；（6）展文化：深耕企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发展的软实力。

（二）未来发展战略

公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展 PCB 相关产业、成为业界的领导者”的良好愿景。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，扎根中国大陆、布局全球，持续发挥在技术研发与精益管理方面的核心优势，坚持发展高阶产品，深化产业链协同发展，进一步完善“One Avary”的产业布局，公司将着力强化以 AI 产品为核心的重要技术攻关与重点资源投入，推进高阶 HDI 及 SLP 产能建设，紧抓光模块代际升级与 AI 服务器供应链多元化的市场机遇，依托“One Avary”全品类平台与全球化交付体系，实现新增产能的有效对接与有序消化，精确掌握市场趋势与潮流，面对人工智能时代为 PCB 产业带来的历史性机遇，以全系列产品矩阵的优势，全面覆盖 AI 云、管、端全链条，巩固并扩大行业领先地位，实现可持续高质量发展。

六、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资及类金融业务的认定标准

根据中国证监会发布的《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，财务性投资和类金融业务界定如下：

1、财务性投资

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。”

2、类金融业务

“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况

2026 年 7 月 3 日，发行人召开第四届董事会临时会议审议通过了本次向特定对象发行股票相关事项。自本次发行相关董事会决议日前六个月（2026 年 1 月 3 日）至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务，具体分析如下：

1、投资类金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司未投资类金融业务。

2、非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司未投资金融业务，亦不存在集团财务公司。

3、与公司主营业务无关的股权投资

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司对外股权投资如下：

单位：万元

投资时间	投资对象	金额	与公司主营业务的联系
2026年1月	科宜高分子	2,000.00	成都科宜高分子科技有限公司（以下简称“科宜高分子”）是一家从事新型高性能基础树脂研发、生产、销售的高新技术企业，为 PCB 行业上游覆铜箔板（CCL）的关键材料供应商，投资该企业有利于公司了解核心底层材料前沿发展趋势。 科宜高分子以苯并噁嗪树脂为核心产品，同时对环氧树脂、酚醛树脂、双马来酰亚胺树脂等高性能热固树脂进行改性研究、生产销售及技术服务，其产品可应用于算力领域 PCB 产品的高等级电子覆铜板。通过投资科宜高分子，公司可了解算力领域 PCB 产品的核心原材料前沿发展趋势，及时跟进工艺技术发展动态，在新材料配方应用成熟时快速更新产品方案，保持技术和产品的领先性。
2026年7月	三英精控	2,000.00	三英精控（天津）仪器设备有限公司（以下简称“三英精控”）是一家专注于超精密运动控制技术和产品的专业制造商，产品可应用于 AI 服务器 PCB 产品的量检测设备，亦可为光通讯（光模块、光纤耦合）提供底层运动控制能力。 三英精控为公司产业链上游的关键精密运动控制系统解决方案提供商，能够提供公司研发及生产过程中所需量检测平台及技术，投资该企业有助于满足公司研发及生产需求，具备良好的协同。 同时，三英精控作为光通讯领域的设备供应商，公司亦可与其在光通讯领域开展协同，为光通讯客户提供适配生产加工需要的 PCB 产品。
2026年9月	感图科技	3,375.00	上海感图网络科技有限公司（以下简称“感图科技”）是一家专注于高端制造领域智能化品质管控及良率管理的工业 AI 企业，其 AI 视觉检测方案可应用于 FPC/HDI/SLP 等 PCB 产品的生产过程，以提升 PCB 制造企业的良率与质检效率。 通过投资感图科技，公司可加速 AI 工具在生产制造环节的落地应用，进一步提升公司在 PCB 制造领域的智能化程度。

如上表所示，公司相关对外股权投资均与主营业务相关。

因此，自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公

司不存在与主营业务无关的股权投资。

4、投资产业基金、并购基金

2026年7月，公司以自有资金向深圳市联道泽泰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资2,090万元，占其49.76%份额。合伙企业投资方向为单一投资标的，主要以直接或间接的方式投资于伏羲半导体（深圳）有限公司（以下简称“伏羲半导体”），增资完成后，合伙企业对应持股比例为10.26%。

伏羲半导体专注于提供企业级存储软硬件研发及方案交付，具有**基板管理控制器（BMC）**芯片自研能力、服务器软件系统开发能力，可面向各类企业客户提供各类细分领域的定制化产品。伏羲半导体核心团队在服务器管理BMC芯片领域深耕多年，在服务器管理领域经验丰富。BMC芯片（Baseboard Management Controller，基板管理控制器）能实时监控服务器硬件健康状态，还能实现远程电源控制、远程运维等关键功能，是数据中心自动化运维的核心组件。

借助本次投资，公司一方面可与伏羲半导体就企业级存储领域的PCB产品应用特征、性能需求等开展技术交流；另一方面可借助与伏羲半导体的投资关系触达企业级存储领域的下游客户资源，探讨未来合作可能性。公司可依托伏羲半导体在企业级存储及关键芯片的技术优势，充分发挥产业协同效应，进一步强化在AI算力领域的技术竞争力，积极把握AI算力需求持续增长带来的战略机遇。因此，该项投资与公司主营业务相关。

除上述情形外，本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在新设立或投资产业基金、并购基金的情形。

5、拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在拆借资金的情形。

6、委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在委托贷款的情形。

7、购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本募集说明书签署日，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

根据上述财务性投资（包括类金融投资）的认定标准并经核查，公司本次发行相关董事会决议日（2026年7月3日）前六个月即2026年1月3日起至本募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施财务性投资及类金融业务的情形。

（三）最近一期末是否存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至2026年6月30日，发行人可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关会计科目情况如下：

单位：万元

序号	项目	主要内容	账面价值	认定为财务性投资的金额
1	其他应收款	应收产能保证金、应收少数股东出资款等	56,007.40	-
2	其他流动资产	待抵扣进项税等	75,307.49	-
3	其他权益工具投资	公司围绕产业链相关环节的对外投资	337,977.05	-
4	其他非流动金融资产	公司参与投资的产业投资基金及并购基金	79,058.72	51,492.13
5	长期股权投资	对联营企业的投资	1,901.99	-
6	其他非流动资产	预付工程设备款及长期保证金	86,404.79	-
合计			636,657.46	51,492.13
占归属于母公司所有者净资产的比例			18.52%	1.50%

截至报告期末，公司持有财务性投资共计 51,492.13 万元，占归属于母公司所有者净资产的比例仅为 1.50%，占比较低，公司不存在持有金额较大的财务性投资。

1、其他应收款

截至2026年6月30日，公司其他应收款账面价值 56,007.40 万元，主要为应收产能保证金、应收少数股东出资款等，不属于财务性投资。

2、其他流动资产

截至2026年6月30日，公司其他流动资产账面价值为 75,307.49 万元，主要为待抵扣进项税等，不属于财务性投资。

3、其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资账面价值为 337,977.05 万元，“其他权益工具投资”中均为公司对外投资的参股公司，被投资企业的具体明细和投资时间、主营业务、与公司业务的协同性具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	账面价值	初始及后续 投资时点	认缴金额 (注)	实缴金额	持股比例	主营业务情况	投资原因
1	礼鼎半导体	182,211.27	2023 年 1 月	94,500.00	94,500.00	11.96%	礼鼎半导体专注于高阶半导体封装载板 的研发、生产和销售	通过投资礼鼎半导体，一方面有助于公司借此加强半导体领域的战略布局，充分把握电子行业的技术发展趋势，符合公司的战略发展方向；另一方面公司可与礼鼎半导体深化在生产管理及高端制造等方面学习互鉴，充分发挥协同效应，提升公司的市场竞争优势
2	江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“江南新材”）	31,261.49	2025 年 3 月	2,500.00	2,500.00	1.15%	江南新材以铜基新材料为核心，开发生产铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片等材料	江南新材为公司供应磷铜球等 PCB 核心耗材，投资该企业有利于保障公司高端板材原料稳定、品质可控并优化成本
3	京隆科技（苏州）有限公司（以下简称“京隆科技”）	19,584.90	2025 年 1 月	6,000.00	6,000.00	1.13%	京隆科技为 IC 独立测试厂，提供客户整合性后段 IC 服务包含逻辑与模拟类芯片测试、存储测试、CMOS 影像感应器封装测试	京隆科技提供晶圆针测、终测等全流程专业测试服务。投资京隆科技有利于公司了解高端半导体应用场景的技术发展趋势，有利于双方联合研发适配半导体测试的 PCB 方案，强化技术协同与市场拓展
4	江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森半导体”）	22,624.00	2019 年 6 月	3,005.60	3,005.60	1.82%	艾森半导体主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务，主要产品包括电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂以及可用于 PCB 线路板的电镀液及配套试剂、感光油墨等	艾森半导体为公司所在电子元器件行业上游的电子化学品供应商，投资该企业有助于公司加强上下游企业合作，实现产业链协同发展
5	苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“新广益”）	9,576.20	2025 年 12 月	3,000.00	3,000.00	0.93%	新广益主要从事电子专用材料研发制造、电子元器件生产及塑料橡胶制品销售，业务涵盖抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等功能性材料的研发与生产	新广益提供抗溢胶膜、强耐受性膜等核心耗材，为公司供应商，投资该企业有利于保障公司高端 FPC 产品品质与交付

序号	项目名称	账面价值	初始及后续 投资时点	认缴金额 (注)	实缴金额	持股比例	主营业务情况	投资原因
6	天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“三英精密”）	10,859.60	2022 年 1 月、2022 年 4 月	1,588.58	1,588.58	2.57%	三英精密是国内高端 X 射线无损检测装备的制造商，主营业务为 X 射线三维显微镜、X 射线在线检测等高端无损成像设备及 X 射线高分辨工业 CT 设备的研发和制造，其开发的背钻 CT 检测设备可用于 AI 服务器 PCB 产品的检测	三英精密及三英精控为公司产业链上游的高端设备制造商，能够提供公司研发及生产过程中所需检测设备及技术，投资该企业有助于满足公司研发及生产需求，具备良好的协同性
7	三英精控	2,709.98	2022 年 2 月、2022 年 3 月	950.00	950.00	4.52%	三英精控主营业务为纳米级运动控制平台及系统研发、制造、销售	
8	东莞六淳智能科技股份有限公司（以下简称“六淳科技”）	8,357.42	2020 年 12 月	3,000.00	3,000.00	3.94%	六淳科技主要从事电子产品精密功能性器件的研发、生产和销售，通过对多种功能性材料进行设计、组合、生产、加工，以实现终端电子产品及其组件的特定功能	六淳科技为公司上游精密功能性器件的供应商，双方自 2017 年起开始合作，投资该企业有利于保障公司供应链稳定，实现产业链协调发展
9	昆山鸿仕达智能科技股份有限公司（以下简称“鸿仕达”）	18,270.00	2023 年 2 月	2,000.00	2,000.00	1.60%	鸿仕达为智能制造整体解决方案供应商，主要服务于消费电子、新能源、5G 通信及泛半导体领域	鸿仕达为公司上游自动化设备供应商，报告期内公司向鸿仕达采购与主营业务相关的自动化设备，投资该企业有利于公司更好实现生产自动化和智能化，并有助于公司加强上下游企业合作
10	无锡盈达科技股份有限公司（以下简称“盈达科技”）	4,600.31	2022 年 6 月	2,000.00	2,000.00	3.46%	盈达科技专注于自动识别与数据采集（AIDC）行业，主要产品为工业用 PDA、扫描枪、RFID 读取等移动物联网信息终端产品，主要应用于新零售、物流、制造等行业客户	盈达科技为公司数字化转型所需的上游智能硬件制造商，投资该企业有助于公司掌握和了解物联网及智慧工厂相关技术，为自身数字化转型积累先进技术及经验
11	感图科技	4,026.15	2021 年 2 月、2024 年 3 月	1,636.72	1,636.72	3.73%	感图科技为工业人工智能解决方案供应商，主要业务是将人工智能技术应用于工业精密检测、视频分析及决策场景	感图科技提供 FPC/HDI/SLP 等 PCB AI 视觉检测方案，投资该企业有利于提升公司制造良率与质检效率
12	科宜高分子	7,939.85	2025 年 11 月、2026 年 1 月	5,836.87	5,836.87	10.05%	科宜高分子从事新型高性能基础树脂研发、生产、销售的高新技术企业，为 PCB 行业上游覆铜箔板（CCL）的关键材料供应商	科宜高分子为公司上游高阶覆铜箔板（CCL）提供特种高性能树脂，投资该企业有利于公司了解核心底层材料前沿发展趋势

序号	项目名称	账面价值	初始及后续 投资时点	认缴金额 (注)	实缴金额	持股比例	主营业务情况	投资原因
13	深圳云豹智能股份有限公司（以下简称“云豹智能”）	3,829.25	2024 年 8 月	3,000.00	3,000.00	0.27%	云豹智能专注于云计算和数据中心数据处理芯片（DPU）和解决方案	云豹智能产品适配 AI 服务器硬件架构，投资该企业有利于公司在 AI 服务器领域把握行业技术发展趋势、拓宽下游渠道
14	广东德聚技术股份有限公司（以下简称“德聚技术”）	4,231.87	2023 年 6 月	2,500.00	2,500.00	1.03%	德聚技术专注于高性能材料的研发、应用支持、生产及销售	德聚技术为公司上游电子胶粘剂的重要供应商，报告期内公司向该公司采购与主营业务相关的电子胶粘剂，投资该企业有利于保障公司供应链稳定，实现产业链协调发展
15	鼎勤科技（深圳）有限公司（以下简称“鼎勤科技”）	3,985.47	2025 年 4 月	2,000.00	2,000.00	5.00%	鼎勤科技为 PCB、封装载板和半导体领域提供自动化设备、垂直化学设备及高端电镀设备	鼎勤科技主营 PCB 压合智能化设备及湿制程设备，适配公司 HDI、SLP 生产需求，投资该企业有利于稳定公司核心设备供应
16	德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“德中技术”）	1,517.86	2025 年 2 月	2,500.00	2,500.00	4.96%	德中技术以激光直接加工技术为核心，开发生产激光微加工设备、快速电路板制作成套设备	德中技术专注 PCB 激光切割、精密分板、线路成型等专用设备，匹配公司 FPC 精密加工需求。投资该企业有利于双方深化工艺协同，优化精密制程精度，支撑高端产品迭代与产能扩建
17	深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“航盛电子”）	1,050.00	2022 年 9 月	1,333.00	1,333.00	0.31%	航盛电子聚焦汽车电子行业，产品阵容覆盖智能座舱、智能驾驶辅助系统、新能源汽车控制系统等，与全球众多整车厂及供应商拥有长期紧密合作关系	航盛电子在汽车电子行业具备深厚的技术、客户、渠道资源，投资该企业有利于公司车载用板成功导入更多汽车电子企业供应链体系，实现业务协同与资源共享，助推公司车载用板业务发展
18	湖北奥马电子科技有限公司（以下简称“奥马电子”）	1,341.44	2022 年 8 月	791.10	791.10	3.60%	奥马电子是一家专门研究生产挠性覆铜板材料及覆盖膜的技术性制造企业，其产品广泛应用于消费电子、工控设备、医疗器件、车载、物联网等领域	奥马电子主要产品挠性覆铜板及覆盖膜是公司 PCB 产品的基础原材料。投资该企业有利于保障公司供应链稳定，了解上游技术发展趋势
合计		337,977.05	-	-	-	-	-	-

注：认缴金额和实缴金额系指参与该项股权投资的初始本金金额，下同。

如上表所示，上述参股公司均与公司具有业务协同性，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

2026 年 3 月，深圳市广和通无线股份有限公司披露其以现金方式购买航盛电子控制权，目前具体交易仍在推进中。

除上述情形外，截至本募集说明书签署日，公司上述对外投资暂不存在其他处置计划。

4、其他非流动金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动金融资产账面价值为 79,058.72 万元，“其他非流动金融资产”中均为公司参与投资设立的产业投资基金及并购基金，具体如下：

单位：万元

序号	企业名称	账面价值	初始及后续投资时点	认缴金额	实缴金额	持股比例	注册资本	设立原因
1	北京晨壹并购基金（有限合伙）（以下简称“晨壹基金”）	25,509.48	2020 年 3 月、2022 年 4 月	20,000.00	20,000.00	2.94%	680,000.00	晨壹基金聚焦科技与先进制造、医疗与健康、消费与服务三大领域，专注于企业中后期内生和外延成长机会，创造产业整合价值，推动产业结构优化和升级
2	春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华景智”）	25,982.65	2021 年 9 月、2022 年 9 月、2022 年 11 月、2023 年 5 月、2024 年 3 月、2024 年 6 月、2025 年 2 月、2025 年 7 月	15,778.00	15,778.00	20.00%	78,890.00	春华景智聚焦于智能科技领域的优质项目，重点投资人工智能、智能制造和新一代信息技术等行业
3	宁波顶擎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波顶擎”）	27,469.50	2020 年 4 月	1,269.00	1,269.00	21.25%	470.69	宁波顶擎主要业务为对外持有合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）股权并获取相关投资收益，芯碁微装主要产品包括 PCB 直接成像设备及自动线系统等
4	CHINA RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE LPF（以下简称“CRPIF 基金”）	97.09	2025 年 8 月	20,432.70（3,000 万美元）	97.09（14.26 万美元）	4.62%	规模不超过 6.5 亿美元	CRPIF 基金主要系为了响应消费电子品牌企业关于碳排放的目标而成立，其通过投资光伏、风电等新能源基础设施及配套储能项目，产生环境权益并分配给合伙人

（1）晨壹基金

晨壹基金聚焦科技与先进制造、医疗与健康、消费与服务三大领域，专注于企业中后期内生和外延成长机会，创造产业整合价值，推动产业结构优化和升级。

公司参与投资设立该产业基金有利于公司在电子产业链的纵向拓展、横向整合及优质项目资源储备，充分利用晨壹基金及相关方在投资并购领域的专业优势和公司在产业链中的业务优势，长远来看将有利于加快推动公司产业发展战略的顺利实施。

截至 2026 年 6 月 30 日，晨壹基金对外投资企业包含部分生物医药、消费、动物医疗保健、软件等与公司主营业务协同效应有待进一步显现的企业，基于谨慎性考虑，将公司对晨壹基金的投资认定为财务性投资。

（2）春华景智

春华景智聚焦于智能科技领域的优质项目，将重点投资于人工智能、智能制造和新一代信息技术等领域。通过投资春华景智，未来将有助于在先进技术的应用，工业 4.0 的推进以及产业资源共享等方面给公司带来协同效益。

截至 2026 年 6 月 30 日，春华景智投资企业与公司现有业务的协同效应有待进一步显现，基于谨慎性考虑，将公司对春华景智的投资认定为财务性投资。

（3）宁波顶擎

宁波顶擎为对芯碁微装股权的持股平台，不涉及其他对外投资。芯碁微装专注服务于电子信息产业中 PCB 领域及泛半导体领域的客户，通过优秀产品帮助客户在提升产品品质和降低生产成本的同时实现数字化、无人化、智能化发展。报告期内，公司向芯碁微装采购 PCB 设备。公司通过投资宁波顶擎间接持股产业链上游设备制造商，有利于形成良好的产业协同效应，该项投资与公司主营业务密切相关。因此，公司对宁波顶擎的投资不属于财务性投资。

（4）CRPIF 基金

CRPIF 基金主要系为了响应消费电子品牌企业关于碳排放的目标而成立，其通过投资光伏、风电等新能源基础设施及配套储能项目，产生环境权益并分配给合伙人。

公司投资 CRPIF 基金主要系为了获取高质量的绿色权益，以满足消费电子

品牌企业对供应商的碳排放要求，并非为了获取财务增值收益。公司投资 CRPIF 基金属于为了获取关键资源要素而进行的投资，投资与公司业务存在协同，不属于财务性投资。

截至本募集说明书签署日，公司上述对外投资暂不存在处置计划。

5、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 1,901.99 万元，包括公司联营企业广东展扬、无锡永阳，公司对其投资时间、投资金额、持股比例、主营业务、与公司业务的协同性具体如下：

单位：万元

序号	被投资单位	账面价值	初始及后续投资时点	认缴金额	实缴金额	持股比例	主营业务情况	投资原因
1	广东展扬	202.41	2020 年 4 月	420.00	420.00	44.00%	主要提供激光类、贴合类、智能物流、追溯系统等标准及非标设备开发	广东展扬为 PCB 生产提供系列自动化设备及综合智能解决方案，助力公司更好实现生产自动化和智能化，并有助于公司加强上下游企业合作。
2	无锡永阳	1,699.58	2025 年 10 月	765.00	765.00	45.90%	专注传感器研发设计、生产销售及技术服务	为了进一步强化在汽车电子领域的实力，深化在车用 PCB 下游应用与系统整合方面的能力，公司于 2025 年 10 月以现金对价受让无锡华阳 53.68% 股权，无锡华阳成为公司非全资子公司，其联营企业无锡永阳认定为公司长期股权投资。

上述长期股权投资与公司具有业务协同性，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，或以收购或者整合为目的的并购投资，故不属于财务性投资、类金融业务。

截至本募集说明书签署日，公司上述对外投资暂不存在处置计划。

6、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 86,404.79 万元，主要为预付工程设备款及长期保证金，不属于财务性投资。

综上，截至报告期末公司不存在金额较大的财务性投资。

七、报告期内利润分配政策、现金分红政策的制度及执行情况

（一）利润分配政策

1、现行《公司章程》对利润分配政策的相关规定

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，公司在《公司章程》中对与利润分配相关的条款进行了明确的规定。《公司章程》中有关利润分配政策的主要内容如下：

“第一百六十二条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

第一百六十三条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配形式与原则

公司采取现金、股票或者现金股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

公司现金股利政策目标为稳定增长股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的期间间隔

公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年度至少进行一次利润分配。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，公司资产负债率高于80%，当年经营活动现金流量净额为负值的，可以不进行利润分配。

在满足日常经营的资金需求、可预期的重大资金支出安排的前提下，公司可以进行中期分红。

（三）利润分配的条件

1、现金方式分红的条件和比例

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、发放股票股利的具体条件

若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分配的前提下，提出实施股票股利分配预案。

采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

（四）利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东会审议，经股东会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东会审议。

2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

3、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、审计委员会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。

5、公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。

6、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（五）利润分配政策调整的决策机制与程序

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的有关规定。

2、利润分配政策的调整应经董事会审议后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

2、未来三年股东回报规划

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，制订了公司未来三年（2026年-2028年）的股东回报规划，具体内容如下：

“一、制定股东回报规划考虑因素

公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司未来战略发展目标的基础上，兼顾各类股东意愿，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、股东回报规划的制定原则

公司现金股利政策目标为稳定增长股利，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑中小股东的意见。

三、股东回报规划的具体内容

（一）利润分配的形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合或法律法规允许的其他方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润。

（二）利润分配的期间间隔

公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，每年度至少进行一次利润分配。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，公司资产负债率高于 80%，当年经营活动现金流量净额为负值的，可以不进行利润分配。

在满足日常经营的资金需求、可预期的重大资金支出安排的前提下，公司可以进行中期分红。

（三）现金分红的条件和比例

在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大资金支出安排，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

（四）发放股票股利的具体条件

若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分配的前提下，提出实施股票股利分配预案。

采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

四、利润分配的决策程序与机制

1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东会审议，经股东会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数董事表决通过，方可提交股东会审议。

2、独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

3、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东

特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

4、审计委员会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。

5、公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途。

6、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

五、利润分配政策的调整机制

1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规的有关规定。

2、利润分配政策的调整应经董事会审议后提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、附则

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过起生效实施。”

（二）报告期内发行人利润分配情况

公司最近三年现金分红情况具体如下：

单位：万元

分红年度	现金分红	合并报表中归属于上市公司股东的净利润	现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比重
2025 年度	231,753.67	373,784.35	62.00%
2024 年度	231,805.10	362,035.14	64.03%
2023 年度	115,454.55	328,695.32	35.13%
最近三年累计现金分红占最近三年年均合并报表中归属于上市公司股东净利润的比重		163.18%	

报告期内，公司实施的股利分配均为现金分红，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定。

（三）公司未分配利润使用安排情况

截至 2026 年 6 月末，公司累计未分配利润为 1,645,382.31 万元。为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，未分配利润主要用于项目建设及营运资金，扩大业务规模，以满足公司经营需要，最终实现股东利益最大化。

八、同业竞争情况

（一）关于同业竞争的情况

1、公司与控股股东、间接控股股东之间同业竞争情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,317,536,658 股，其中美港实业直接持有公司 64.54%的股份，为公司的控股股东，其一致行动人集辉国际直接持有公司 5.65%股份。截至 2026 年 6 月 30 日，臻鼎控股间接持有美港实业和集辉国际 100%的股份，合计间接控制发行人 70.19%的股权，为发行人的间接控股股东。

具体情况详见本募集说明书“第二节 发行人基本情况”之“二、股权结构、控股股东及实际控制人情况”之“（二）控股股东及实际控制人情况”之“1、控股股东及实际控制人基本情况”部分。

发行人的控股股东美港实业为注册于中国香港的控股公司，间接控股股东臻鼎控股为注册于开曼群岛的控股公司，二者本身并无实际生产经营业务，与发行人之间不存在同业竞争。

2、公司与控股股东、间接控股股东控制的其他企业之间同业竞争情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人控股股东美港实业未控制其他企业；发行人与间接控股股东臻鼎控股控制的除美港实业及其子公司外的其他企业之间同业竞争情况如下：

序号	企业名称	主营业务	同业竞争关系
1	臻鼎科技	半导体芯片载板、封装、测试及销售业务	无

序号	企业名称	主营业务	同业竞争关系
2	Monterey	控股公司，无实际生产经营业务	无
3	Coppertone	控股公司，无实际生产经营业务	无
4	集辉国际	控股公司，无实际生产经营业务	无
5	FAT	控股公司，无实际生产经营业务	无
6	新加坡臻鼎	控股公司，无实际生产经营业务	无
7	Zhen Ding Developer India Private Limited	物业管理	无
8	礼鼎国际	半导体芯片载板销售业务	无
9	礼鼎半导体	半导体芯片载板、封装及测试业务	无
10	礼鼎秦皇岛	制造公司，半导体芯片载板、封装及测试业务	无
11	嘉维实业	建筑的业务开发，目前无实际经营	无
12	先丰通讯	多层印制电路板研发、生产及销售	不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，已委托发行人经营管理
13	Leading Interconnect Semiconductor Technology Limited	控股公司，无实际生产经营业务	无
14	佰鼎科技股份有限公司	半导体芯片载板、封装、测试及销售业务	无
15	GAEEA Technology Limited	环保节能服务	无
16	曜鼎深圳	水污染治理及环保咨询服务	无
17	曜鼎秦皇岛	水污染治理及环保咨询服务	无
18	曜鼎淮安	危险废物经营及水污染治理	无

（1）发行人与臻鼎控股控制的其他主体从事的半导体芯片载板等业务不存在同业竞争

臻鼎控股控制的存在实质生产经营的企业（不含发行人及其子公司）中，臻鼎科技、礼鼎国际、礼鼎半导体、礼鼎秦皇岛及佰鼎科技均从事半导体芯片载板、封装及测试相关业务，与发行人的主营业务印制电路板业务在产品用途、主要客户、产品规格、原材料及生产制程上均有较大差异，不构成同业竞争。嘉维实业、Zhen Ding Developer India Private Limited 主要从事建筑的业务开发或物业管理，与发行人不存在同业竞争。GAEEA Technology Limited 主要从事环保节能服务，曜鼎深圳及曜鼎秦皇岛主要从事水污染治理及环保咨询服务，曜鼎淮安主要从事危险废物经营及水污染治理，与发行人亦不存在同业竞争。

（2）发行人与先丰通讯不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争

先丰通讯成立于 1987 年 6 月 8 日，系中国台湾的车用雷达板制造商，并于 1990 年在中国台湾证券交易所上市（股票代码为 5349.TW），2019 年 1-9 月其营业收入规模为 557,358 万新台币。2020 年 3 月 10 日，臻鼎控股与先丰通讯双方董事会决议通过收购先丰通讯 100% 股权，收购完成后先丰通讯从中国台湾证券交易所退市。发行人与先丰通讯之间虽均从事印制电路板研发、生产及销售，但先丰通讯经营规模较小，同类收入或者毛利占发行人主营业务收入或者毛利的比例均不足 5%，不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。

（二）控股股东及其关联人所出具的关于避免同业竞争的承诺

2017 年 10 月 25 日，控股股东美港实业及其关联方集辉国际、间接控股股东臻鼎控股出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就与公司避免同业竞争事宜作出如下承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与发行人及其下属企业存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。

2、本公司及本公司直接或间接控制的下属企业未来将不会以任何形式直接或间接从事与发行人及其下属企业经营的业务构成同业竞争或潜在同业竞争的业务或活动，不会直接或间接控股、收购、兼并与发行人及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业或其他经济组织。

3、如本公司及本公司直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可参与或入股任何可能会与发行人及其下属企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，本公司将于其受拘束的相关法律法规许可的范围内，立即通知发行人，以适当方式将该等商业机会优先提供予发行人及下属企业，由发行人及下属企业在相同条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与发行人及下属企业产生同业竞争。

4、本承诺函自出具之日起生效，且在本公司为发行人的控股股东/控股股东的关联方期间持续有效。

5、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担因违反上述承诺而产生的相应赔

偿责任。”

此外，臻鼎控股已于 2023 年 3 月 14 日出具《关于解决与先丰通讯股份有限公司存在业务相同或相似的承诺》：

“1、在符合相关法律、法规及政策允许且先丰通讯的业绩、合规性符合 A 股相关要求的前提下，臻鼎控股将自该等条件全部满足之日起 1 年内，尽力促使先丰通讯与鹏鼎控股协商启动通过适用法律和政策允许的方式对先丰通讯和鹏鼎控股的业务进行整合，以避免潜在的同业竞争关系。2、本承诺直至适用法律规定对某项承诺的内容无要求或根据适用法律的规定本公司无需继续执行本承诺项下义务时，相应部分自行终止。”

（三）本次发行对公司同业竞争的影响

发行人本次募集资金将全部用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。发行人募集资金投资项目的投资方向属于发行人的主营业务，系继续投向发行人原有业务，投资项目实施后，发行人不会与控股股东及其一致行动人、间接控股股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争。

（四）独立董事对发行人是否存在同业竞争及避免同业竞争措施的有效性所发表的意见

公司独立董事对公司是否存在同业竞争及避免同业竞争措施的有效性发表了如下独立意见：“公司业务独立于公司控股股东、实际控制人，以及其控制的其他企业，公司与控股股东及实际控制人不存在构成重大不利影响的同业竞争；公司控股股东及实际控制人严格遵守避免同业竞争承诺，切实维护了公司及股东的利益；公司为避免同业竞争所采取的措施可行、有效。”

九、报告期内违法违规情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在下列情形：

1、现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责。

2、发行人或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查。

3、发行人控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

4、发行人最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

十、发行人最近一期业绩波动情况

2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 172.17 亿元，同比增长 5.14%；实现毛利额 41.28 亿元，同比增长 32.17%；期间扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8.92 亿元，同比下降 22.31%。

因业务结构存在差异，PCB 行业内各公司最近一期业绩波动存在差异。2026 年以来，受存储芯片短缺等因素影响，全球消费电子市场面临一定压力。公司凭借在高端产品的研发和业务积累，通讯用板和消费电子及计算机用板业务收入总体企稳；同时，公司在算力领域的业务规模快速提升。

在此背景下，2026 年 1-6 月，公司产品结构持续优化，高附加值、高毛利的产品营收占比稳步提升，毛利率从去年同期的 19.07%提升至 23.98%，毛利额同比增加 10.05 亿元，业务综合盈利能力增强。但与此同时，受研发费用同比增加 5.25 亿元、财务费用同比增加 5.51 亿元（其中汇兑损失增加 4.54 亿元）等因素影响，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比减少。

目前，公司已向算力领域的全球头部客户实现量产出货。未来随着公司新增产能释放，算力领域业务规模有望逐步放量，带动公司经营业绩提升。

十一、报告期内深交所对公司年度报告的问询情况

2026 年 6 月，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对鹏鼎控股（深圳）股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2026〕第 690 号），主要经营业绩、财务数据变动情况进行问询。公司就相关问题进行了逐项落实并完成回复。

十二、与发行人有关的舆情情况

截至本募集说明书签署日，发行人不存在影响本次发行的重大舆情情形。

第三节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

1、“十五五”规划明确科技产业的重点地位，PCB 产业为国家发展新质生产力奠定坚实基础

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（“十五五”规划）明确了科技产业在“十五五”期间的重点地位，提出关键元器件、先进新材料、集成电路等短板领域强化政策扶持。“十五五”规划提出，要加快人工智能前沿技术攻关，统筹推进算力、算法、数据要素规模化供给，持续完善全国算力基础设施建设；大力培育新能源、航空航天、低空经济等战略性新兴产业，推动相关产业形成规模化产业集群；同时立足长远发展布局未来产业，重点扶持 6G 通信、具身智能、脑机接口等前沿领域产业化落地。

PCB 是承载电子元器件并连接电路的桥梁，广泛应用于集成电路、人工智能、通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，是现代电子信息产品中不可或缺的电子元器件。“十五五”规划为高端 PCB 产品的下游应用打开增量空间，为 PCB 行业技术升级与产能扩张提供了政策支撑，PCB 产业亦将为发展新质生产力奠定坚实基础。

2、下游应用领域蓬勃发展，人工智能为 PCB 行业提供新的增长引擎

随着下游人工智能、光通信、云计算、物联网、可穿戴设备、智能家居等新兴领域的蓬勃发展，PCB 行业正迎来新一轮结构性发展机遇。Prismark 数据显示，2025 年全球 PCB 市场规模达 858.36 亿美元，同比增长 16.68%，增长主要由 AI 基础设施建设、高速网络升级及卫星通信需求驱动。Prismark 预测，2025 年至 2030 年全球 PCB 市场产值将以 11.00% 的年复合增长率持续成长，到 2030 年将达到 1,446.10 亿美元，其中，服务器及数据存储领域、有线通信领域的 PCB 需求增速最为突出。

全球 AI 数据中心资本开支持续扩张背景下，AI 服务器、高速光模块作为算力网络建设的核心硬件载体，其市场规模快速增加。根据高盛在 2026 年 8 月 5 日发布的研究报告，2026-2028 年全球 AI 服务器 PCB 市场规模有望达到 135.60

亿美元、375.29 亿美元、836.45 亿美元，各年增长率为 172.23%、176.76%、122.88%。

3、高阶 HDI 产品高度契合算力领域对 PCB 产品的高阶化、高精密化需求

伴随人工智能算力产业快速扩容、持续迭代升级，AI 服务器、高速光模块等相关产品朝着高集成、高速率、高密度方向演进。为实现超大带宽传输、低信号损耗、高密度布线与大功率散热的性能目标，产业链对配套 PCB 产品在高频高速、超薄基材、精细线路、多层层压等方面的技术标准要求持续抬升，PCB 的线宽、线距、孔径、孔中心距都在不断下降。

高阶 HDI 进一步细化线路，线宽线距更小，可以承载更多的功能模组，且图形精细化程度及可靠性均可满足高端产品的需求，性能特征契合 AI 服务器和高速光模块等领域的应用需求。根据 Prismark 数据，全球 HDI 市场规模将从 2025 年的 161.97 亿美元增长至 2030 年的 300.10 亿美元，市场规模增量为 138.13 亿美元。

公司持续专注并深耕 PCB 产品技术研发，研发投入连续多年位居 A 股 PCB 上市公司首位。早在行业发展初期，公司便深耕 mSAP 等高精密 PCB 技术，技术优势与 AI 相关领域对 PCB 的高阶化、高精密化需求高度契合。

4、公司深耕 PCB 行业多年，在算力领域具备深厚基础，目前正加速布局以把握行业发展机遇

公司深耕 PCB 行业多年，为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造、销售与服务能力的专业大型厂商，产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、RPCB、Rigid Flex 等多类产品。在中国电子电路协会（CPCA）中国电子电路排行榜中，公司连续多年位列中国第一。在 Prismark 以营收计算的全球 PCB 企业排名中，公司 2017 年-2025 年连续九年位列全球第一。

为把握新一轮 AI 推动的产业发展机遇，公司以 ONE AVARY 产品技术平台为核心，构建覆盖 AI 全场景的“云-管-端”全链条 PCB 解决方案。在智能终端领域，公司是折叠手机、AI 手机、XR 模组等终端装置的核心供货商，是全球最大 AI 眼镜 PCB 制造商，目前已与多家机器人客户建立合作关系。在 AI 服务器领域，公司已开发支持 GPU 模块的高阶 HDI、内埋元件等创新技术，高阶 HDI 产品成功打入 AI 服务器市场并陆续开始向头部服务器厂商量产出货。在高速光

模块领域，公司 SLP 产品已切入 800G/1.6T 高端市场并实现量产出货，3.2T 产品已进入研发阶段。

面对 AI 所开启的行业发展浪潮，2025 年，公司加强了产能布局的战略规划与实施力度，公司全年购建固定资产、无形资产、长期资产支付的现金达 66.3 亿元，同比增长 133.0%，投入规模位列 A 股同行业上市公司首位。公司计划进一步在中国淮安、中国深圳、泰国等地的产业园区新增产能投资，为 AI 云端与管端业务领域的进一步拓展奠定坚实基础。

（二）本次向特定对象发行的目的

1、积极把握新一轮科技革命的历史性机遇，巩固公司行业龙头地位

当前，以人工智能为核心的新一轮科技革命正席卷全球，正在深刻重塑传统产业工作范式，未来必将赋能千行百业。人工智能技术的迭代与应用落地，催生了算力需求的指数级增长，成为驱动全球算力基础设施建设的核心引擎。随着大模型训练、推理及多场景智能化应用持续渗透，数据中心建设加速扩容，AI 服务器、高速交换机、光通信等核心算力设备需求呈爆发式增长。

PCB 作为“电子系统产品之母”，是 AI 服务器、高速光模块等硬件的核心互联载体与基础支撑，直接受益于算力基础设施建设浪潮，行业从“量增”迈向“量价齐升”的结构性升级新阶段，高端产能供需缺口持续扩大，技术壁垒与市场集中度同步提升。

为积极把握人工智能产业爆发的历史性机遇，抢抓 AI 算力基础设施建设红利，公司拟通过本次再融资，聚焦高端 PCB 产能扩张与技术升级，重点投向算力领域高阶 HDI 产品。本次融资将助力公司突破产能瓶颈、强化技术壁垒、优化产品结构，全面对接全球头部客户需求，巩固行业龙头地位。

2、进一步扩大产能，提升公司盈利能力

通过本次发行，公司将进一步提升资本实力，同时通过募投项目实施新增约 65.56 万平方米高阶 HDI 年产能，进一步扩大算力领域所需的高阶 HDI 产品业务规模。

随着新增投资逐步落地，公司在算力领域的 PCB 产能将实现显著提升，凭

借领先的技术实力、稳定的产品品质及高效的交付能力，公司有能力推动算力领域业务高速增长，充分释放 AI 浪潮下的业绩增长潜力，为股东创造更大价值。

3、优化资本结构，提升经营稳健性

近年来，随着生产研发和产能建设的持续投入，公司的资金需求进一步提高。为了满足公司发展需要，公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金，优化公司资本结构。公司拟将募集资金用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，增强公司资金实力，满足未来公司业务规模持续增长的资金需求，提高公司抗风险能力，进而提升盈利能力与经营稳健性，实现公司的可持续发展。

二、发行对象及与发行人的关系

本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册后，由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，按照相关规定并根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行证券的价格、定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行的最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册批文后，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 10%，且募集资金总额不超过 960,000.00 万元（含本数），最终向特定对象发行股票数量计算至个位数（计算结果向下取整），并以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会及其授权人士在股东会授权范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关规定并根据发行询价结果协商确定。

若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送红股、转增股本等除权事项以及回购或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行股票数量的上限将作相应调整。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

（三）限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的发行对象通过本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

（四）本次发行融资间隔和融资规模合理性的说明

根据《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条规定，“上市公司应当理性融资，合理确定融资规模”。

根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第四条：

“（一）上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十。

（二）上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。

（三）实施重大资产重组前上市公司不符合向不特定对象发行证券条件或者本次重组导致上市公司实际控制人发生变化的，申请向不特定对象发行证券时须运行一个完整的会计年度。

（四）上市公司应当披露本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向，并结合前述情况说明本次发行是否“理性融资，合理确定融资规模”。”

本次向特定对象发行股票的数量不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的10%。

公司前次募集资金为2018年9月首次公开发行的募集资金，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《普华永道中天验字（2018）第0555号验资报告》，其资金到位时间为2018年9月11日，距离本次发行董事会决议日的时间间隔已超过18个月。

本次证券发行募集资金总额不超过960,000.00万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，募投项目拟投入募集资金960,000.00万元。公司拟将投入上述项目的募集资金主要用于工程、设备及软件购置等，均属于资本性支出。本次募集资金使用并非为持有财务性投资。截至报告期末，公司亦不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

本次发行募投项目的总投资金额为 1,273,001.16 万元，拟投入募集资金总额未超过项目总投资额。募集资金拟投资项目的必要性和可行性具体参见本募集说明书“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金投资项目的必要性和可行性”。

综上，本次证券发行数量、融资间隔、募集资金金额及投向具备合理性，符合“理性融资，合理确定融资规模”的要求。

四、募集资金金额及投向

本次发行拟募集资金总额不超过 960,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目	1,273,001.16	960,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

五、本次发行是否构成关联交易

截至本募集说明书签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至本募集说明书签署日，本公司总股本为 2,317,536,658 股，美港实业是公司的控股股东，公司无实际控制人；美港实业及一致行动人集辉国际合计持有公司 70.19%的股份。

按照本次向特定对象发行股票的数量上限测算，本次发行结束后，美港实业仍为公司控股股东，公司无实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第四届董事会临时会议、2026年第一次临时股东会审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

本次发行拟募集资金总额不超过 960,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目	1,273,001.16	960,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹资金解决。

上述募集资金投资项目的可行性分析如下：

一、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

（一）项目实施的必要性和经营前景

1、提升公司高端 PCB 产能，匹配 AI 算力产业爆发式市场需求

AI 算力硬件是智能经济与算电协同的底层支撑，AI 服务器、交换机等配套算力基础设施对 PCB 的性能、材料、工艺提出了更高要求。作为 AI 算力基建的核心硬件，AI 服务器通常需要搭载多颗高性能 GPU 或 CPU，这对 PCB 的层数、材料以及制造工艺提出了严苛要求；高速光模块则承载着算力集群间海量数据的低延迟传输，对 PCB 的高频材料与精密制程亦提出严苛标准。

随着人工智能技术的快速发展及算力需求的持续提升，AI 服务器与高速光模块的迭代升级成为推动高阶 HDI 需求增长的核心动力。根据 Prismark 数据，2025 年 HDI 产值达 161.97 亿美元，同比增速高达 29.4%，为所有细分品类中 fastest；2025 年至 2030 年，全球 HDI 的市场规模将进一步增长至 300.10 亿美元，其中全球服务器及数据存储领域和有线通信领域的年复合增速分别为 28.1%、32.3%。

报告期内，公司 HDI 产品整体产能利用率快速提升，目前已接近产能瓶颈。随着算力领域客户需求快速增加，公司高阶 HDI 相关产品项目已进入快速上量阶段，现有 HDI 产能对后续增量订单的承接能力已构成显著制约。

为顺应下游爆发式增长的市场需求，抢抓 AI 产业发展机遇，公司亟须突破高端 PCB 产能瓶颈，开展高端产能升级与扩张。本项目建设是公司完善高端 PCB 产能布局的关键举措，有利于巩固并提升公司在算力领域 PCB 产品的市场占有率，夯实长期发展基础。

2、深度布局 AI 算力配套赛道，巩固并提升公司行业龙头地位

全球人工智能产业正处于高速渗透、算力需求持续扩容的关键阶段，AI 服务器、高速光模块是算力网络建设的核心硬件载体。相较于传统 PCB 产品，算力领域配套 PCB 技术壁垒高、下游认证严苛、产品附加值高；同时 AI 算力供应链高度集中，头部客户对 PCB 供应商的技术实力、交付能力、合规资质要求严苛，行业准入壁垒持续抬升，行业集中度不断提升。

当前 PCB 行业头部企业均大规模加码 AI 配套 PCB 赛道，行业竞争全面聚焦高端算力 PCB 领域。公司早在 2017 年便开始布局细线路高阶 HDI、SLP 等产品，在高阶 HDI 产品及 SLP 产品的研发制造方面具备深厚技术积淀，拥有优质通信及算力硬件客户资源。为扩大先发竞争优势，公司亟须针对性布局算力领域配套 PCB 产能，深度挖掘下游算力硬件客户核心需求，巩固公司在高端 PCB 领域的龙头地位，助力实现长期战略发展目标。

3、建设高规格智能化产线，顺应 PCB 高频高速化技术升级趋势

随着 AI 算力、高速通信等下游行业技术迭代持续加快，终端硬件产品向高速化、小型化、高密度化方向升级，推动配套印制电路板向高频高速、高密度化发展。AI 服务器及高速光模块用 PCB 产品加工工艺严苛、生产难度大、技术壁垒高，不仅需要高精度生产设备、智能化制造管控体系，更需要长期的技术积累与工艺沉淀；同时高端算力 PCB 下游客户认证周期长、验证标准严格，产业化落地门槛较高。

在此背景下，为顺应行业技术升级趋势，满足高速增长的高端算力 PCB 市场需求，紧抓产品结构高端化升级机遇，公司通过本次募投项目建设高规格智能化生产车间，投入先进生产及配套设备，强化高端产品供应能力，优化产品结构，持续推进 AI 算力配套高端 PCB 的战略布局，增强公司核心技术竞争力与长期盈利水平。

（二）项目实施的可行性和发行人的实施能力

1、国家产业政策大力支持 PCB 行业发展，为项目的实施提供了良好的政策环境

印制电路板行业是电子信息制造业的核心基础组件，承担着电子元器件电气连接与信号传输的关键功能，其技术水平和产业规模直接关系到整个电子信息产业链的安全与竞争力。近年来，我国政府对 PCB 行业发展高度重视，出台了一系列国家级战略规划与产业扶持政策，为行业高质量发展提供了系统性制度保障。

2023 年至 2025 年间，《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》等文件，不仅将高密度互连积层板明确纳入鼓励类产业，还对行业在产业布局、生产规模、工艺技术、智能制造、绿色制造及资源环境保护等方面提出了引导性要求，推动企业提升研发投入与人均产值，加快自动化、数字化与绿色化转型升级。同时，《战略性新兴产业分类（2018）》《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》等文件将高端印制电路板列为战略性新兴产业和数字经济核心产业，进一步凸显了 PCB 行业在国家经济结构调整和数字经济发展中的战略地位。

综上所述，国家对 PCB 行业高质量发展的政策扶持与推动，为项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

2、全球 PCB 市场规模稳步扩大，未来发展空间广阔

PCB 主要承担电子元器件间的电路导通与信号传输功能，是电子设备的关键基础组件，被誉为“电子产品之母”。在 AI 的强力驱动下，PCB 行业实现了快速增长。根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 产值达 858.36 亿美元，同比增长 16.7%，这是全球 PCB 产值自 2021 年以来再度实现两位数增长。在智能化、低碳化等因素的驱动下，人工智能、新能源汽车、5G/6G 通信、物联网及智能终端等 PCB 下游应用行业预期将蓬勃发展，将带动 PCB 市场规模持续扩容。Prismark 预测，2030 年全球 PCB 产值将达到 1,446.10 亿美元，增量空间巨大。

根据 Prismark 数据，2025 年中国大陆 PCB 产值达 496.52 亿美元，在全球市场的份额进一步提升，达到 57.8%，连续二十年位居全球第一。根据 Prismark 预

测，未来五年中国大陆 PCB 行业仍将持续高速增长，2030 年中国大陆 PCB 产值将达到 817.64 亿美元，2025 年至 2030 年复合年均增长率为 10.5%，市场前景广阔。

3、PCB 作为 AI 算力系统的“神经中枢”呈现量价齐升，整体市场规模快速扩张

AI 应用快速发展迭代下，科技大厂持续加大 AI 基础设施投入，AI 服务器市场景气上行。AI 服务器整机出货量保持高速增长，直接带动 PCB 整体需求量持续扩容。同时，AI 服务器搭载多颗 GPU 芯片，内部算力板卡、高速互联背板等数量大幅增加，单台设备 PCB 用量数倍于传统服务器，叠加数据中心交换机、光模块等配套硬件需求，AI 算力领域对 PCB 产品的需求显著扩容。

此外，大模型训练和推理集群逐渐从数千颗 GPU/XPU 扩展至数万乃至数十万颗，数据中心内部需要在更短时间内完成更大规模的参数同步、梯度交换和推理数据流转，网络互连逐渐从“配套资源”转变为影响算力利用率的关键瓶颈，PCB 作为算力系统的“神经中枢”的性能要求越来越高，单位价值呈现显著提升。

在此背景下，全球 AI PCB 市场呈现量价齐升，整体市场规模快速扩张。根据 Prismark 数据，全球 PCB 市场规模将从 2025 年的 858.36 亿美元增长至 2030 年的 1,446.10 亿美元，市场规模增量为 587.74 亿美元；其中全球 HDI 市场规模将从 2025 年的 161.97 亿美元增长至 2030 年的 300.10 亿美元，市场规模增量为 138.13 亿美元。

根据高盛 2026 年 8 月发布的研究报告，2026-2028 年全球 AI 服务器 PCB 市场规模有望达到 135.60 亿美元、375.29 亿美元、836.45 亿美元，各年增长率为 172.23%、176.76%、122.88%。

4、公司在相关领域具备深厚的技术积累和丰富的研发生产经验，为项目提供了技术保障

HDI 通过微孔释放板面空间，通过精确设置盲、埋孔减少通孔数量，以节约 PCB 可布线面积，在有限的空间内容纳更多的元件。HDI 是 PCB 高密度、高精度、高集成化的体现，对可靠性有着极高的要求。从加工环节看，HDI 产品难点

主要集中在“孔、铜、线、对位”四类能力，PCB 厂商需要兼具先进设备、工艺参数和流程管控的系统能力，在钻孔、填铜、曝光及检测等环节形成稳定组合，才能满足高阶 HDI 板对良率和可靠性的要求。

公司早在行业发展初期便深耕 HDI、SLP 等高精密 PCB 技术，技术优势与 AI 服务器对 PCB 的高阶化、高精密化需求高度契合，具备突出的技术先发优势。公司自 2017 年起布局 mSAP 技术，并在消费电子领域实现规模化量产，具备微米级线宽线距加工能力。凭借在消费电子领域的长期积累，公司在精细线路大规模量产方面具有丰富的制造经验和人才储备，产品良率、品质在行业内均处于领先地位。

近年来，公司已将相关工艺逐步应用于算力领域产品，并针对算力领域产品生产制造过程的特殊工艺进行开发，相关产品已向全球头部客户量产出货，完成了 HDI 产品制造的跨领域迁移。

公司在消费电子领域积累了丰富的 HDI 产品量产经验，有助于缩短算力领域 HDI 产品的产能爬坡周期、提高生产稳定性，能够较好地保障下游客户的交付周期和交付质量要求。

5、优质的客户资源为项目实施提供良好市场条件

公司是全球少数可全面开展 PCB 产品设计、研发、制造及销售一体化服务的大型专业厂商。凭借先进的核心技术、稳定可靠的高端产品与专业高效的配套服务，公司在算力领域和端侧应用产品领域已与全球知名的终端厂商和 ODM 厂商建立长期稳定的合作关系。

在 AI 服务器领域，公司高阶 HDI 产品成功打入 AI 服务器市场并陆续开始向头部服务器厂商量产出货；在高速光模块领域，公司 SLP 产品已切入 800G/1.6T 高端市场并已实现量产出货，并与客户合作开发下一代 3.2T 光通讯解决方案。相关产品的突破与量产出货，充分印证了公司在高端 PCB 领域的技术实力与市场认可度。此外，依托全球化客户布局优势，公司建立全球多基地运营模式，可充分覆盖全球 AI 算力硬件市场需求。

优质且丰富的客户资源，不仅为项目投产后提供稳定的订单来源，同时持续赋能公司前沿技术迭代与产品升级，为本项目实施提供充分的市场可行性。

（三）项目与现有业务或发展战略的关系

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。公司现有业务为各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务，拟投资项目与公司当前主营业务方向相符合，有利于公司巩固行业地位，进一步提升公司的技术水平和运营服务能力，从而进一步增强公司的盈利能力和核心竞争力。

（四）发行人资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总额为 1,273,001.16 万元，拟使用募集资金金额为 960,000.00 万元。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

（五）关于主营业务与募集资金投向的合规性

1、符合国家政策要求说明

发行人主营业务为各类印制电路板的研发、设计、制造、销售与服务，本次募集资金投向庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。具体如下：

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人主营业务归属于“电子元件及电子专用材料制造”中的“电子电路制造”，行业代码为 C3982。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人业务属于“1.新一代信息技术产业之 1.2 电子核心产业之 1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》等文件均把本次募集资金投向的产品高密度互连积层板明确纳入鼓励类产业。

2、关于募集资金投向与主业的关系

公司在 HDI 产品领域耕耘多年，HDI 产品广泛应用于手机、笔记本电脑等消费电子产品的主板、高速光模块的主板、AI 服务器的 GPU 加速模块卡、汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）主板等。

公司过往深耕消费电子领域，在该领域收入占比较高。近年来，公司陆续在算力领域推进产品开发、客户认证，目前已形成一定收入规模，且保持较快增速。本次募投项目与公司主营业务密切相关，系公司面向算力领域的高阶 HDI 产品及 SLP 产品的产能扩充，是公司为顺应 AI 算力产业爆发式需求、响应下游客户更高等级应用需求而做出的重要布局，符合公司战略。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）项目情况

本次募集资金投资项目为庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，其具体情况如下：

1、项目基本情况

本项目在现有开发技术及生产工艺的基础上，依托公司现有产业园厂房并拟新建厂房及配套公用设施，引进成型设备、镀铜设备、钻孔设备、压合设备、自动化设备、防焊设备、品保设备等先进生产设备，并配置高素质的生产、技术、管理等人员，打造面向算力领域的高端 PCB 智能化生产基地。

2、项目投资概算

本项目总投资 1,273,001.16 万元，其中建筑工程 306,959.88 万元，生产设备购置及安装 949,612.84 万元。项目具体投资构成如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	总投资额	占总投资比例	拟使用募集资金	是否资本性支出
1	工程建设费用	1,256,572.72	98.71%	960,000.00	是
1.1	建筑工程	306,959.88	24.11%		
1.2	生产设备购置及安装	949,612.84	74.60%		
2	铺底流动资金	16,428.44	1.29%	-	否
项目总投资		1,273,001.16	100.00%	960,000.00	-

本项目建筑工程投资金额系结合当地市场价格、公司以往项目投资、新项目实际需求等情况估算；生产设备购置及安装投资金额系根据产能规划和产品技术方案确定所需设备类型和数量，同时结合相关设备的近期采购价格或市场价格进

行测算。本项目拟使用募集资金 960,000.00 万元，不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。

3、项目实施进展和整体进度安排

本次募投项目预计同步开展新厂房建设和依托现有厂房的设备购置，分阶段购置投入设备。本项目建设期三年，投入进度安排如下：

进度阶段（年）	项目投入进度（每季度为 1Q）											
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
前期规划与工作												
工程建设												
设备购置与安装												
人员招聘与培训												
试运营												

本项目预计将于建设期第 2 年开始投产，第 6 年达到满产状态。

4、项目实施主体和实施地点

本项目的实施主体为公司全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司，实施地点为江苏省淮安市淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号。本项目将基于现有土地实施，公司全资子公司庆鼎精密已于 2026 年 3 月 23 日取得证号为“苏（2026）淮安市不动产权第 0013926 号”的不动产权证书。

5、项目经济效益情况

经测算，本项目达产当年将新增收入 1,213,522.16 万元；项目达产期平均净利率为 12.63%，税后内部收益率为 15.38%，静态投资回收期为 6.88 年。

6、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）产品产量及销量

本项目预计将从建设期第 2 年开始投产，当年整体产能达到项目总体规划产能的 20%，第 3 年整体产能达到 40%，第 4 年达到 60%，第 5 年达到 80%，第 6 年达到 100%。同时基于谨慎性考虑，假设项目产能利用率为 95%。项目假设产量与销量相同。

（2）销售价格预测

基于谨慎性原则，考虑到当前整体行业产能较为紧张，未来随着同行业公司新增产能落地，下游供需状况稍有改善，在历史期间数据基础上假设了每年的价格降幅。

（3）销售成本预测

本次募投项目中人工成本采用募投规划劳动定员和年工资情况进行计算，年工资成本考虑了人工成本上涨的影响。

折旧摊销费用包括本次募投规划建筑工程及设备所产生的折旧摊销费用，以及依托现有厂房部分的折旧摊销费用。

对于直接材料和折旧摊销、间接人工以外的其他制造费用，结合本次募投项目产品的产量，并根据公司同类产品历史单耗金额，考虑未来原材料成本可能涨幅进行预估。

（4）期间费用测算

本次募投项目各项费用参考公司历史经营数据进行预估。

（5）税金测算

本项目增值税率按 13% 计算，城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加分别按增值税的 7%、3%、2% 计算，所得税率按 15% 计算。

（6）效益指标对比

根据公开披露信息，本次募投项目与同行业公司类似项目的测算毛利率对比如下：

公司名称	项目名称	测算毛利率
方正科技	人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目	25.00%
胜宏科技	越南胜宏人工智能 HDI 项目	25.98%
生益电子	人工智能计算 HDI 生产基地建设项目	26.95%
鹏鼎控股	庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目	25.32%

注 1：产品毛利率均为达产后毛利率平均数。

注 2：上表中仅列示同行业公司披露产品毛利率的类似项目。

如上表所示，公司本次项目测算毛利率在同行业类似项目区间内，预估较为谨慎。

三、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性

本次募集资金投资项目涉及的立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项均已完成，具体如下：

本次募投项目将基于现有土地实施，公司全资子公司庆鼎精密已于 2026 年 3 月 23 日取得证号为“苏（2026）淮安市不动产权第 0013926 号”的不动产权证书。

2026 年 7 月，本次募投项目取得淮安经济技术开发区行政审批局发放的《江苏省投资项目备案证》（淮管发改审备〔2026〕210 号，项目代码：2604-320871-89-05-931181）。

2026 年 7 月，本次募投项目取得淮安市生态环境局经济技术开发区分局出具的《关于庆鼎精密电子（淮安）有限公司庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目环境影响报告表的批复》（淮环开分表复〔2026〕26 号）。

2026 年 8 月，本次募投项目取得江苏省发展和改革委员会出具的《关于庆鼎精密电子（淮安）有限公司庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目节能报告的审查意见》（苏发改能审〔2026〕97 号）。

四、本次募集资金直接或变相用于类金融业务的情况

本次募集资金用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，不存在直接或变相用于类金融业务的情况。

五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”

（一）本次发行满足“两符合”相关要求

发行人本次发行满足《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

1、公司主营业务及本次募投项目符合国家产业政策的情况

公司深耕 PCB 行业多年，为全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造、销售与服务能力的专业大型厂商，产品范围涵盖 FPC、SMA、SLP、

HDI、RPCB、Rigid Flex 等多类产品。公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，符合国家产业政策和公司的发展战略。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人主营业务归属于“电子元件及电子专用材料制造”中的“电子电路制造”，行业代码为 C3982。根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，发行人业务属于“1.新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《鼓励外商投资产业目录（2025 年版）》等文件均把本次募集资金投向的产品高密度互连积层板明确纳入鼓励类产业。

公司承诺，公司本次向特定对象发行股票拟募集资金扣除发行费用后将全部用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，不会直接或变相用于“两高”（即高耗能、高排放）项目。

2、募集资金主要投向主业

公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，募投项目系围绕发行人现有主营业务展开，支持公司主营业务发展，符合主板定位要求。

综上，公司主营业务及本次募集资金投向符合国家产业政策要求，符合主板定位要求。

（二）发行人不涉及“四重大”的情形

截至本募集说明书签署日，公司主营业务及本次发行募集资金投向不涉及情况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不存在影响本次发行的重大舆情；未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法违规线索，本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

综上，本次发行满足“两符合”，不涉及“四重大”，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》以及《监管规则适用指引——发行类第 8 号》的相关规定。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，有助于提升公司的核心竞争力、持续盈利能力和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金投资项目建成后，公司主营业务范围不会发生变更，公司目前没有业务及资产的重大整合计划。若公司未来对主营业务及资产进行整合，将根据相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，另行履行审批程序和信息披露义务。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况

截至本募集说明书签署日，本公司总股本为 2,317,536,658 股，美港实业是公司的控股股东，公司无实际控制人；美港实业及一致行动人集辉国际合计持有公司 70.19%的股份。

按照本次向特定对象发行股票的数量上限测算，本次发行结束后，美港实业仍为公司控股股东，公司无实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况

发行人本次募集资金将全部用于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目，投资方向属于发行人的主营业务，系继续投向发行人原有业务。投资项目实施后，发行人不会与控股股东及其一致行动人、间接控股股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争。

四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况

本次发行完成后，公司控股股东、间接控股股东及其关联人的关联交易不会因本次发行而发生重大变化，公司将继续按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务，保证该等关联交易的合规性和公允性，符合上市公司和全体股东利益，保证不损害中小股东利益。

五、实施募投项目而新增的折旧和摊销对发行人未来经营业绩的影响

公司本次募投项目总投资 1,273,001.16 万元，其中基建工程 306,959.88 万元，生产设备购置及安装 949,612.84 万元，建成后将新增算力领域 HDI 产能 65.56 万平方米。

随着本次募投项目达产，项目效益得到释放，公司预计新增营业收入、利润总额规模持续扩大，折旧摊销对公司经营业绩的影响将逐步降低。本次募集资金投资项目新增折旧摊销预计在项目开始建设起第四年达到峰值 11.30 亿元，占公司当年营业收入¹的比例为 2.41%，处于合理水平。

因此，公司预计实施募投项目而新增的折旧和摊销不会对未来经营业绩产生重大不利影响。

¹ 假设营业收入为公司 2025 年营业收入与本次募投项目当年新增营业收入的合计；上述假设仅用于测算本次募投项目新增折旧对未来业绩的影响，不构成任何盈利预测，投资者不应据此进行决策。

第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况

公司最近五年内不存在募集资金情况。

公司最近一次募集资金行为系 2018 年首次公开发行股票，募集资金净额为 360,122.84 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已全部使用完毕，不存在变更募集资金用途的情形。

第七节 与本次发行相关的风险因素

一、宏观经济风险

（一）全球宏观经济波动风险

PCB 作为电子产品和信息基础设施不可缺少的基础电子元器件，其应用范围广泛，与全球宏观经济形势关联度较高。目前，全球供应链格局、贸易流动模式以及经济增长范式面临重构，地缘政治因素亦为全球主要经济体的经济形势增添了新的不确定性。全球宏观经济波动可能对电子产品行业造成直接影响，进而对 PCB 行业产生影响，可能为公司经营带来一定的不确定性。

（二）全球贸易格局变化的风险

公司主要客户为境外企业，2025 年以来，随着国际贸易环境复杂性提升，全球贸易格局发生变化。若未来国际贸易摩擦进一步加剧升级，将会对整体经济运行、上下游产业链带来较大冲击，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。公司作为全球化经营的大型企业，经营业绩将可能面临全球贸易变化带来的风险。

二、经营风险

（一）行业变化较快及市场竞争加剧的风险

公司产品的主要下游领域为通讯、消费电子及计算机产品，具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求，或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公司无法及时开发新客户、无法对新的市场需求和技术趋势作出及时反应，公司业绩将受到不利影响，未来将可能面临丧失竞争优势的风险。

（二）客户相对集中风险

公司深耕 PCB 行业多年，专注于为国际知名通讯电子、消费电子及计算机等行业优质客户提供高质量、定制化的 PCB 产品。最近三年内公司对前五大客

户的销售收入占其营业收入的比例均超过 80%，客户集中度相对较高，单一大客户对公司业绩的影响较大。未来公司在与主要客户的合作中，主要客户的经营状况或业务结构变化、新产品迭代不及预期等有可能带来公司业绩的波动风险。

（三）原材料供应和价格波动风险

公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将对公司产品的毛利率水平产生一定影响。此外，公司生产中需要大量电力，电力供应及电力价格亦受能源供应及能源价格波动影响。当前全球地缘政治冲突与气候变化持续加剧，全球能源及大宗商品市场价格出现波动。公司可能面临原材料和能源成本上涨的经营风险。

与此同时，下游电子行业迅猛发展，带动了行业需求的快速增长，并传导至 PCB 产品上游。在此背景下，主要原材料可能存在短期内产能紧张的情形，公司可能面临原材料供应的经营风险。

（四）环保风险

PCB 的生产过程涉及电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物，生产过程对环保的要求较高。发行人在生产运营中，积极配合当地环保部门履行环保义务，投入大量人力、财力、物力完善环保设施、提高环保能力，并制定了严格的环保制度，建立了权责清晰的环保部门。

但随着国家对环境保护的日益重视，民众环保意识的不断提高，国家可能会制定更加严格的环保标准并对环境污染事件责任主体进行更为严厉的处罚，发行人在不断对现有环保设施进行升级改造并购买新型设备的同时，还应不断完善环保工作管理，推进绿色技术引进及创新。环保投入的持续增加，可能对发行人的业绩造成影响；如因发生环境污染事件导致发行人需承担相应责任，则有可能对发行人生产经营造成一定的不利影响。

（五）核心技术人员流失的风险

PCB 产品的成功研发及规模化生产涉及大量复杂交叉学科的知识储备与运用，技术集成度高，需要大量的高素质综合型人才。发行人建立了较为完备的知识产权保护体系，在 PCB 技术专业领域具备多年沉淀，拥有经验丰富的综合型

技术人才储备。但综合型专业人才的培育往往需要经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，耗时较长。若未来核心技术人员流失，可能会对公司的生产经营尤其是新产品研发产生一定的不利影响。

三、财务风险

（一）汇率变动风险

公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为货币资金和经营性应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。报告期内，公司汇兑损失分别为-8,403.93 万元、-40,667.91 万元、17,048.96 万元和 44,754.10 万元。

在全球政治经济格局日趋复杂的背景下，美元汇率走势的不确定性增强。未来若人民币与美元汇率发生大幅波动，可能导致公司产生较大的汇兑损益，引起利润水平的波动，对公司未来的经营业绩造成不利影响。

（二）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，发行人的应收账款账面价值分别为 619,241.83 万元、576,882.21 万元、607,312.79 万元和 490,522.19 万元，占资产总计的比例分别为 14.65%、12.95%、12.43%和 8.99%。若应收账款客户不能按照合同约定支付货款，发生呆坏账，公司将面临坏账损失、流动性及偿债能力不足的风险。

（三）存货发生跌价损失的风险

公司的存货主要由库存商品、原材料、在产品等构成，报告期各期末，公司存货账面价值分别为 305,405.57 万元、335,554.34 万元、380,671.06 万元和 519,450.99 万元，占资产总计的比例分别为 7.22%、7.53%、7.79%和 9.52%。由于下游客户需求不断增长，以及产能的稳定供应存在一定不确定性因素，公司保持合理的备货水平以保障供货稳定。未来随着公司业务规模的不断扩大，公司存货的绝对额仍有可能随之上升。若公司不能对存货进行有效的管理，将因下游客户需求变动而发生滞销、库存商品产品价格下降等原因产生存货跌价损失，对公司未来的经营业绩将产生一定的不利影响。

（四）经营业绩波动风险

2026 年 1-6 月，公司产品结构持续优化，高附加值、高毛利相关产品营收占比稳步提升，带动整体毛利率水平改善，但与此同时，受研发费用、财务费用增加等因素影响，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降 22.31%。

目前，公司的算力领域业务处于爬坡放量阶段，若未来公司相关领域拓展不及预期、所处行业的产业政策、供需情况、原材料和能源价格发生不利变化，或出现其他自身经营的不利因素，则可能对公司的经营业绩、**本次募投项目的效益实现**产生不利影响。

四、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目不及预期的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发展趋势的判断作出的，在公司募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术革新、产业政策调整、市场变化、行业整体扩张导致竞争加剧等诸多不确定因素，该等因素对募投项目实施有较大影响。如募集资金投资项目未能如期实现效益，或投产后市场情况发生不可预见的变化、公司不能有效开拓新市场，公司产能扩大后将存在一定的产品滞销风险，募集资金投资项目新增折旧及摊销也将导致公司净资产收益率出现一定下降。

（二）固定资产折旧增加的风险

本次募集资金投资项目中固定资产投资规模较大，在项目建设达到预定可使用状态后，公司将新增较大金额的固定资产折旧。**本次募集资金投资项目新增折旧摊销预计在项目开始建设起第四年达到峰值 11.30 亿元，占公司当年营业收入的比例为 2.41%**。如果募投项目市场拓展不足，在固定资产折旧增加的同时，无法实现预期的投资收益，将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

（三）新增产能不能及时消化的风险

本次募投项目实施后，公司将新增约 65.56 万平方米高阶 HDI 年产能。由于相关项目完全投产尚需一定时间，在后续项目实施及经营过程中，如果行业政策、下游客户需求、市场环境发生重大不利变化，或公司相关产品市场开拓不及预期，

可能将导致本次募投项目新增产能不能及时消化，可能会对项目预期投资收益及公司盈利能力产生一定不利影响。

（四）募投项目实施及同时实施多个建设项目的风险

本次募集资金拟投资于庆鼎 AI 服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。在实施本次募投项目的同时，公司亦将基于市场前景、客户需求、经营战略等因素推进其他项目建设。同时实施多个建设项目对公司的管理能力、经营能力、人员储备、资金实力提出了更高的要求。若未来公司及子公司连续实施多个建设项目的能力不足，可能导致募投项目实施效果不及预期，进而对公司经营产生不利影响。

五、向特定对象发行股票项目相关风险

（一）募集资金不足或发行失败的风险

公司本次发行采用向特定对象发行的方式，董事会审议通过本次发行方案时尚未确定发行对象。本次发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案认可程度以及市场资金面情况等多种因素的影响，因此本次发行可能存在募集资金不足甚至发行失败的风险。

（二）净资产收益率下降及即期回报被摊薄风险

本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于本次募投项目的投入、建设、运营存在一定周期，经济效益不能立即体现，公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，公司存在因本次发行完成后股本和净资产增加而引起的短期内净资产收益率下降和每股收益被摊薄的风险。

（三）发行审批风险

本次发行尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否通过深交所审核及取得中国证监会的批复，以及最终通过审核及取得批复的时间尚存在不确定性。

（四）股票价格波动风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，亦受行业景气度、宏观经济形势、国家产业政策、货币政策、股票市场整体供求关系、投资者

心理预期等多种外部因素的影响。同时，公司本次向特定对象发行尚需履行相关审批程序，需要一定的时间方能完成，在此期间，公司股票的市场价格可能会出现波动，直接或间接对投资者造成损失。

第八节 与本次发行相关的声明

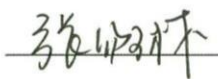
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

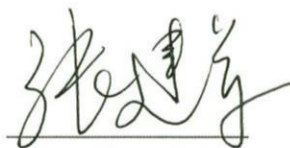
董事：



沈庆芳



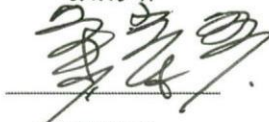
张沕琳



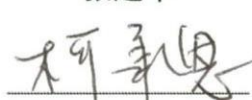
张建军



魏学哲



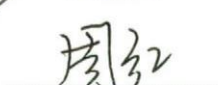
黄崇兴



柯承恩



林益弘



周红

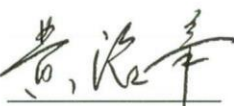


王志兴

除董事外的高
级管理人员：



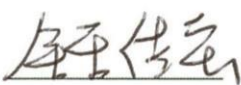
陈国声



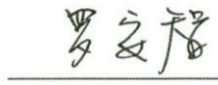
黄治峯



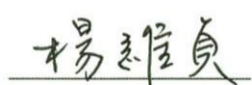
萧得望



钟佳宏



罗安智



杨维贞



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

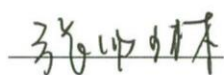
2020年 10 月 27 日

二、发行人审计委员会声明

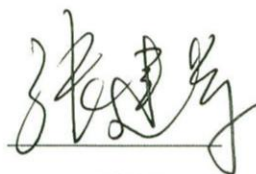
本公司及全体审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员

会成员：



张沕琳



张建军



魏学哲



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2026年10月27日

三、发行人控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：美港实业有限公司（Mayco Industrial Limited）

控股股东的法定代表人
（或主要机构负责人）：

For and on behalf of
MAYCO INDUSTRIAL LIMITED
美港实业有限公司

.....
Authorized Signature(s)
沈庆芳

2026年10月27日

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

间接控股股东：臻鼎科技控股股份有限公司
(Zhen Ding Technology Holding Limited)

间接控股股东的法定代表人
(或主要机构负责人):

For and on behalf of
Zhen Ding Technology Holding Limited
臻鼎科技控股股份有限公司

.....
Authorized Signature(s)
沈庆芳

2026年10月27日

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东关联方：

集辉国际有限公司
(Pacific Fair International Limited)

控股股东关联方的法定代表人
(或主要机构负责人)：

For and on behalf of
PACIFIC FAIR INTERNATIONAL LIMITED
集 輝 國 際 有 限 公 司

.....
(Authorized Signature(s))
沈庆芳

2026 年 10 月 27 日

四、保荐人声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

陈阳
陈 阳

保荐代表人：

冯原
冯 原

宁小波
宁小波

董事长、法定代表人（或授权代表）：

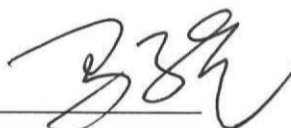
江禹
江 禹

华泰联合证券有限责任公司



本人已认真阅读鹏鼎控股（深圳）股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理：


马 骁

保荐机构董事长（或授权代表）：


江 禹

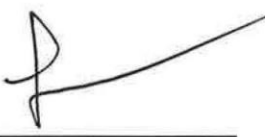
华泰联合证券有限责任公司



五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

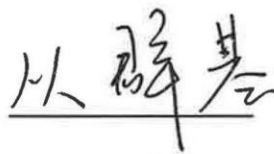


龚牧龙

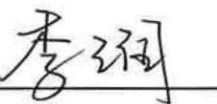
经办律师：



苏 峥



从群基



李 润



关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市
募集说明书的会计师事务所声明

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会：

本所及签字注册会计师已阅读鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书(以下简称“募集说明书”), 确认募集说明书中引用的有关经审计的 2023、2024 及 2025 年度财务报表, 与本所出具的上述审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述审计报告的内容无异议, 确认募集说明书不致因完整准确地引用上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对本所出具的上述报告依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

签字注册会计师


管 坤

签字注册会计师


胡 艺 涵

会计师事务所负责人授权代表


刘 伟

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

2026 年 10 月 27 日



七、发行人董事会声明

（一）董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外，公司未来十二个月将根据业务发展规划、项目投资进度等情况，并结合公司资本结构、融资成本等因素综合考虑是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，详见公司于巨潮资讯网发布的《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》。

（本页无正文，为本募集说明书《发行人董事会声明》之签章页）



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会

2024年10月27日